

TESTING
THE FUTURE

26

目次

目次	02
編集方針	03
The Advantest Way	04



Overview	
Group CEOメッセージ	06
Group COOメッセージ	09
FY2025 Highlights	11
History	12
How We Create Value	13
事業セグメント	15
連結財務ハイライト	17
連結非財務ハイライト	18



Strategy	
中長期経営方針「グランドデザイン」	20
第3期中期経営計画（MTP3、2024～2026年度）の概要	21
CFOメッセージ	23
研究開発	25
顧客関係	27
サプライチェーンの拡張性とレジリエンス強化に向けた戦略	29
人財戦略の実行を支える仕組みと施策	32
リスクマネジメント	34



Governance	
取締役会長メッセージ	38
コーポレートガバナンス	39
取締役一覧	46
取締役会のスキルマトリックス	47
新任社外取締役メッセージ	49
社外取締役対談	50



Sustainability	
Introduction	
サステナビリティの取り組み強化	57
サステナビリティマネジメント	59
サステナビリティ行動計画2024-2026	60
サステナビリティ関連のリスク及び機会	62



Planet	
サステナビリティ行動計画2024-2026（地球環境）2025年度進捗状況	63
GHG排出量削減	64
主要イニシアチブへの参画	67
自然資本への取り組み	68
People	
サステナビリティ行動計画2024-2026（社会）2025年度進捗状況	69
人権の尊重	70
サプライチェーン上の人権尊重	71
次世代人財の育成	72
イノベーションを生み出す人財の育成	74
労働安全衛生	75



Data	
11年間の主要財務データ	77



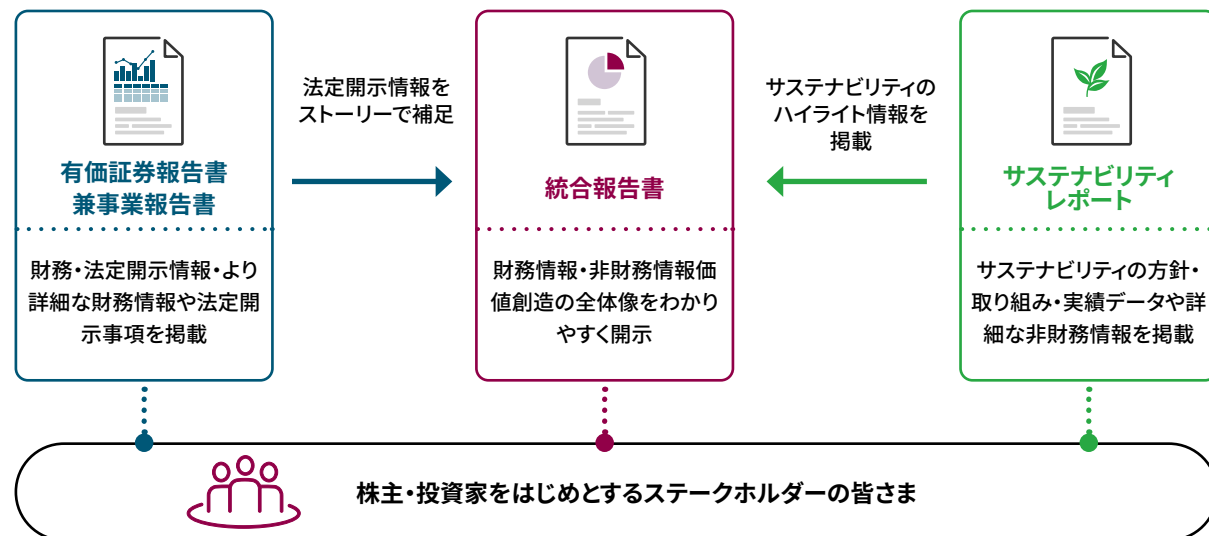
編集方針

半導体の進化が社会や産業の可能性を大きく広げる中、アドバンテストは、テスト技術を通じてその発展を支えています。本統合報告書では、私たちがどのような価値を生み出し、それを次の成長へいかにつなげていくのかを、財務・非財務の両面から描いています。株主・投資家の皆さまをはじめとする幅広いステークホルダーに、法定開示書類だけでは伝えきれない当社の考え方や取り組みを、分かりやすくお伝えすることを目指しています。

また、経営陣のメッセージや対話を通じて、戦略の背景にある考え方や意思決定、将来に向けた課題認識をお伝えするとともに、定量情報だけでは表現しきれない当社の価値観や企業としての個性が伝わる内容を目指しています。

情報開示体系

当社は、企業価値創造に向けた取り組みとその成果を、主に「有価証券報告書兼事業報告書」「サステナビリティレポート」「統合報告書」を通じて開示しています。統合報告書では、財務情報と非財務情報を結び付け、当社の事業、戦略、価値創造の全体像をお伝えしています。より専門的かつ詳細な財務・法定開示情報については「有価証券報告書兼事業報告書」を、サステナビリティに関する方針、取り組み、実績データについては「サステナビリティレポート」をご参照ください。



報告期間・範囲

報告対象期間は2025年度（2025年4月1日～2026年3月31日）で、必要に応じて当期間の前後についても言及しています。データの集計範囲（バウンダリー）は、特に記載しているものを除き、すべて連結決算対象範囲です。

将来の事象に係る記述に関する注意

本冊子には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積もり及び予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知及び未知のリスク、不確実性その他の要因を内包しており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。法令により義務付けられている場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の理由により、将来予想に関する記述を更新または修正することはありません。

The Advantest Way

アドバンテストは1954年の創業以来、計測技術を軸に成長し、半導体テストソリューションのリーディングカンパニーへと進化してきました。

現在7,000名を超える従業員がグローバルに活躍する中、「The Advantest Way」は、地域や文化を越えて従業員が共有する基盤であり、当社の企業理念であると同時に、すべてのステークホルダーへのコミットメントでもあります。

経営理念 (パーパス&ミッション)

我々は何のために存在しているのか？

先端技術を先端で支える

私たちは、世界中の顧客にご満足いただける製品・サービスを提供するために、たえず自己研鑽に励み、最先端の技術開発を通して社会の発展に貢献していきます。

ビジョン

我々は将来どうなりたいのか？

半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテストソリューション・カンパニーへ

当社グループは、提供価値の拡大を通じ、すべてのステークホルダーにとり半導体バリューチェーンで最も信頼でき、最も価値あるテストソリューション・カンパニーとなることを目指します。

コア・バリュー

我々が大事に思うもの

「INTEGRITY」は異なる文化、習慣あるいは意見を受け入れる心であり、グローバルに展開する私たちが持つべきコア・バリューです。

I

Innovation
is our Lifeblood

N

Number One
is our Aspiration

T

Trust
is our Foundation

E

Empowerment
is our Motivation

G

Global
is our Reach

R

Respect
is our Heart

I

Inclusion and Diversity
is our Commitment

T

Teamwork
is our Approach

Y

Yes
is our Attitude



Overview

Group CEOメッセージ	06
Group COOメッセージ	09
FY2025 Highlights	11
History	12
How We Create Value	13
事業セグメント	15
連結財務ハイライト	17
連結非財務ハイライト	18



Group CEO メッセージ

成果を礎に、さらなる成長へ

2025年度も、アドバンテストは着実に成果を積み重ねることができました。AI向け半導体やハイ・パフォーマンス・コンピューティング(HPC)用途に対する旺盛な需要が続く中、売上高、営業利益、当期利益はいずれも過去最高を更新しました。

これらの成果は、私たちが優れたテストソリューションを通じて長年にわたり顧客を支えてきた、その積み重ねが強固な事業基盤として結実したものと受け止めています。先を見据えた計画と重要技術への戦略的な投資により、この1年に生まれた大きな事業機会を捉え、複雑化する高性能デバイスに対応する競争力のあるソリューションを提供することができました。

また、拡大する需要に応えるため生産規模を拡大する顧客を確実に支えるべく、当社自身の生産能力の増強や新たなパートナーシップの構築にも取り組んできました。

AI市場は、2026年度以降も引き続き成長していくと見込んでいます。複雑に絡み合う今日のさまざまな課題に向かい、顧客が新たなイノベーションを迅速に市場へ送り出すことを支援する上で、当社は独自の強みを発揮できる立場にあります。こうした認識から、私は2026年度を、さらなる成長機会を切り拓く1年と捉えています。

テストフロー全体にイノベーションを

私たちの今後の成長を方向づけるのは、引き続きAIに対する需要だと考えています。AI関連の投資は、特定の用途や特定の世代のデバイスだけに限られるものではありません。その影響は、半導体業界全体、さらにはその先のさまざまな分野へと広がっています。

AIチップは、多彩な革新技术が組み合わされた、いわばイノベーションの結晶です。高速プロセッサと広帯域メモリが組み合わせられ、現在では光インターコネクトやフォトンクス技術も取り込まれつつあります。さらに、次世代の先端パッケージング技術は、今後一段と複雑化すると予想されています。

こうした技術には、それぞれ固有のニーズや要件があります。温度制御、電力効率、信頼性、性能など、さまざまな要素が複雑に重なり合うにつれ、高性能デバイスに求められるテスト要件もますます高度化しています。そしてこれは、当社にとって中長期的に大きな事業機会となると考えています。業界最高水準のテストソリューションを提供することで、顧客の歩留まりと品質の向上を支え、より多くの製品を、より迅速に市場へ送り出すことに貢献していきます。

当社の成長機会は、特定の製品領域にとどまりません。SoCテスト、メモリテスト、デバイスインタフェース、ハンド



ダグラス ラフィーバ

代表取締役兼経営執行役員
Group CEO



Group CEO メッセージ

“
私たちが目指しているのは、従来のテスト装置メーカーという役割から一歩進み、統合テストソリューションを提供する企業へと進化することです。”

ラ、システムレベルテスト、ソフトウェアツール、データアナリティクス、関連サービスに至るまで、当社は幅広いポートフォリオを有しています。

顧客要求が広がる中、私たちはこの幅広いポートフォリオを活用し、テスト工程の各段階で優れたソリューションを提供する、統合されたテストフローの構築に取り組んでいます。各テスト工程を統合テストセルによってつなぐことで、テストフロー全体の自動化が可能になります。

この考え方の重要な要素の一つが、半導体業界において「Distribution of Test」として認識されるアプローチです。これは、テスト内容を工程間で柔軟に移行・配分できるようにすることで、顧客がそれぞれのニーズに応じ、効率、テストカバレッジ、コストを最適化しながら、各工程でどのテストを実施するかを決定できるようにするものです。

私たちが目指しているのは、従来のテスト装置メーカーという役割から一歩進み、統合テストソリューションを提供する企業へと進化することです。当社が蓄積してきた専門性を生かし、End to Endで一貫したテストフローを提供することで、需要の拡大に対応して生産規模を拡大する顧客のテスト時間短縮と市場投入期間の短縮に貢献していきます。

当社は、顧客の技術的な要求を深く理解し、テストフロー全体を通じて支援できる強みを備えています。一方で、今後、業界にとって最も大きな課題の一つとなるのは、供給能力であると考えています。AIデバイスに対する需要が加速し続ける中、この前例のない成長を支えるためには、私たち自身も顧客と歩調を合わせ、供給体制を拡大していかなければなりません。

一度に数台の半導体テストを提供することと、数千台規模で供給する場合とでは、求められるオペレーション体制は大きく異なります。今日の半導体テストは、百万点以上に及ぶ部品から構成され、生産、システム統合、サービスの各面で高度な能力を必要とする、極めて複雑なシステムです。さらに、原材料や部品の不足など、現時点では想定していない新たな制約が、将来生じる可能性もあります。こうした課題を先取りするため、私たちは生産能力の拡大とサプライチェーンの強化を継続しています。今から先手を打って投資を進めることで、拡大する顧客の需要に対応するとともに、将来的な供給制約のリスクを低減し、今後求められる供給規模と信頼性を確保していきます。

自動化、効率性、テストアーキテクチャの高度化に取り組む一方で、顧客の需要拡大に対応するために必要な生産能力、サプライチェーン、オペレーション能力にも投資しています。業界がAI主導による次の成長段階へと進む中、技術革新と、拡張性を備えた確実な事業遂行力を両立することが、これまで以上に重要になると考えています。

協働が生み出す新たな価値

半導体技術が高度化する中、あらゆる課題を一社だけで解決することはできません。顧客との関係をさらに深め、さまざまなパートナーとの協働を強化することが、これまで以上に重要になっています。

新たに生まれる要求をより深く理解し、顧客のニーズに即したソリューションを開発するためには、開発の初期段階から顧客と連携する必要があります。Applied Materials社との戦略的パートナーシップに基づくEPIC Platformへの参画は、その重要な例です。

先端パッケージングや新たなデバイスアーキテクチャが複雑化する中、私たちは、前工程の製造と後工程のテストとのつながりを一層強化することを目指しています。この協働を通じて知見を共有し、より早い段階から当社のテストに関する専門性を効果的に生かすことで、前工程から後工程までを視野に入れた統合ソリューションの開発に貢献していきます。

また、長期的な成長が期待される新たな分野を育てる上でも、パートナーシップを積極的に活用しています。その一つが、シリコンフォトリソグラフィです。

AIやHPCの処理規模が拡大する中、光インターコネクト技術は、データセンターのアーキテクチャにおいて、ますます重要な役割を担うと予想されています。この変化に対応するためには、開発段階でのデバイス検証から量産段階でのテストに至るまで、新たなアプローチが求められます。

当社は業界のパートナーと協力し、シリコンフォトリソグラフィ及びCo-Packaged Optics (CPO) デバイス向けの革新的なテストセルを開発しました。これにより、ウェーハレベルでの検証からファイナルテストまで、顧客を一貫して支援しています。

Group CEO メッセージ

“

私は、アドバンテストを一つの庭のようなものだと考えることがあります。それは、絶えず姿を変えながら息づく、生きた存在です。私たちはグローバルチームとして、この庭全体を大切に育てています。ともに土を耕し、水や肥料を与え、枝を整えながら、一つひとつの木を健やかに育てています。強靱なサプライチェーン、人財の育成、安定的なキャッシュ・フローといった経営資源は、この庭を持続的に成長させるために欠かせない力となります。”

研究開発や共同開発に早期から取り組むことで、シリコンフォトニクスデバイスの量産に対応した、差別化されたテストソリューションのポートフォリオを構築してきました。光インターコネクト技術の採用が加速する中、これまで築いてきたパートナーシップ、技術的な専門性、市場におけるリーダーシップを生かし、新たな成長機会を着実に捉えるとともに、急速に進化するこの市場における当社の役割をさらに広げていきたいと考えています。

ここでご紹介したのは、当社が市場に提供するテストソリューションの幅を広げてきたパートナーシップの一例です。今後も、設計からシステムレベルテスト、さらにその先まで、End to Endの量産ニーズをカバーできるよう、エコシステム全体にわたって戦略的なパートナーシップを構築していきます。私たちににとって、協働は将来の成長を支える不可欠な力です。

季節を重ね、未来の成長を育む

今日の半導体業界は、かつて誰も想像できなかったほどの速さで変化しています。これから訪れる機会を確かな成長につなげるためには、長期的な成長と価値創造を支える経営資源への投資を継続することが極めて重要です。

私は、アドバンテストを一つの庭のようなものだと考えることがあります。それは、絶えず姿を変えながら息づく、生きた存在です。

当社の半導体テストは、長年にわたる丹念な手入れを経て、大きく健やかに育った木々にたとえることができます。一方、シリコンフォトニクスなどの新たな投資分野は、ようやく根を張り始めた若木のようなものです。

私たちはグローバルチームとして、この庭全体を大切に育てています。ともに土を耕し、水や肥料を与え、枝を整えながら、一つひとつの木を健やかに育てています。強靱なサプライチェーン、人財の育成、安定的なキャッシュ・フローといった経営資源は、この庭を持続的に成長させるために欠かせない力となります。

経営の役割は、この庭を適切に手入れし、将来にわたって価値が育ち続ける環境を整えることです。持続的な成長とは、目の前の収穫を最大化することだけではありません。年を重ねるごとに、新たな価値が着実に育っていく環境をつくることです。そのためには、経営資源を適切に配分し、将来を見据えて新たな機会に投資するとともに、短期的な業績と長期的な目標を規律をもって両立させなければなりません。季節の移り変わりに応じて私たち自身も変化し、次の世代、さらにその先の世代まで花開く種をまいていく必要があります。

INTEGRITYは、当社の長きにわたる成長を支えてきた礎であり、すべての営みを育む土壌です。70年以上にわたり、敬意と信頼を育み、企業としての私たちらしさを形づくってきました。また、顧客との信頼関係を深め、組織や地域を越えた協働を支え、急速な変化の中でも着実に前進する力を私たちにもたらしめています。当社が成長を続ける中、イノベーションと規律ある事業運営を両立させることは、引き続き重要な課題です。こうした中で、INTEGRITYに対する共通のコミットメントが、地域、機能、事業の違いを越えて私たちを一つに結び付け、私たちが大切にする価値観を損なうことなく、持続的な成長を追求する力となっています。健やかな土壌が庭を支えるように、INTEGRITYは、アドバンテストが今日も成長を続けながら、明日の機会を育んでいくための揺るぎない基盤なのです。

未来の成長を支える基盤づくり

2026年度は第3期中期経営計画の最終年度に当たりますが、当社の成長に向けた取り組みは、その先を見据えています。

アドバンテストの経営理念は、「先端技術を先端で支える」ことです。AIの時代を迎え、その意義はこれまで以上に大きくなっています。顧客やパートナーとの緊密な連携を深め、技術的なリーダーシップをさらに高め、オペレーションと供給能力を強化するとともに、70年以上にわたり当社を支えてきた企業文化を守り、次の世代へと受け継いでいく。こうした取り組みを通じて、私たちは次世代のイノベーションと成長に向けた種をまいています。強固な基盤と明確な目的意識のもと、私たちはこれからも持続的な価値を創出し、半導体バリューチェーンにおいて最も信頼され、価値あるテストソリューション・カンパニーであり続けることができると確信しています。

Group COO メッセージ

グローバルオペレーションを支える、明確な責任と連携の力

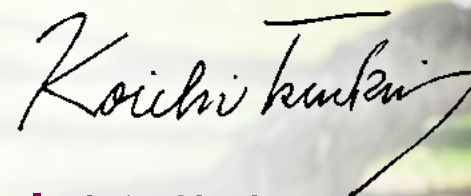
アドバンテストは、半導体市場の成長と技術革新の進展を背景に、グローバルに事業を拡大してきました。こうした環境の中で重要になるのは、多様化する顧客のニーズや変化の速い市場に対して、迅速かつ的確に対応できる経営とオペレーションの基盤をいかに構築するかです。私は、この基盤こそが当社の競争力を支える重要な要素であると考えています。

半導体業界では、技術革新や市場変化のスピードが加速し、開発、生産、販売、サポートに至るバリューチェーンもグローバルに広がっています。こうした環境に的確に対応するため、当社では、意思決定を一部に集中させるのではなく、各領域を最も深く理解するCxOに必要な権限と責任を委譲する体制をとっています。専門性に基づく意思決定の質とスピードを高め、グループ全体が最も力を発揮できる経営を実現することが、グローバルに事業を展開する当社にとって最も実効性の高い経営のあり方だと考えているからです。

この体制のもとで、当社は各経営領域における説明責任を果たしながら、専門性に基づく質の高い意思決定と、部門や地域をまたいだ機動的な連携を実現しています。その結果、グローバルに事業が拡大する中でも、スピード、スケール、一貫性を兼ね備えたオペレーションを維持し、変化に強い経営基盤を築くことができています。

RU・BU・FUの連携が支える実行力

当社のグローバルオペレーションは、Regional Unit (RU)、Business Unit (BU)、Functional Unit (FU) がそれぞれの役割を担いながら、緊密に連携することで成り立っています。RUは、顧客や市場に最も近い立場で、営業、サポート・サービス、サプライチェーンを含む地域オペレーションを担い、各地域の実情に即した迅速な判断と対応を行います。BUは、製品・技術・ソリューションの競争力を高める役割を担い、FUは、財務、人事、ITなどの専門機能を通じて全社共通の基盤を支えています。とりわけ、BUやFUが地域を越えて連携・実行できるよう、RUが各地域の市場や顧客ニーズに即して自律的に支えることで、グローバルで最適なオペレーションを実現している点は、当社の事業運営モデルの重要な特長です。こうした相互連携の積み重ねが、当社のグローバルな実行力の源泉です。



津久井 幸一

代表取締役兼経営執行役員社長
Group COO



Group COO メッセージ

“

現場に近い迅速な意思決定とグループ全体の力の最大化を両立させながら、より生産性が高く、強靱で、信頼される事業基盤の構築に取り組んでいきます。そして、INTEGRITYを土台に、一人ひとりの実行力を結集することで、持続的な成長と企業価値の向上を推進してまいります。”

Group COOとして担う役割

その中で、Group COOである私の役割は、主としてRUを統括する立場から、グローバルオペレーション全体の実効性を高めることにあります。各地域の自律性を生かしつつ、BUやFUとの連携を通じてそれを全社戦略と結び付け、グループ全体が最も力を発揮できる形へと導いていくことが重要な責務です。そうした実行力を通じて、顧客、パートナー、株主をはじめとするステークホルダーへの提供価値を高めていくことが、最終的に目指すべき姿であると考えています。

また、私はITを含むグローバルビジネスオペレーションの領域も管掌しており、オペレーション効率の向上にも継続的に取り組んでいます。事業の成長を支えるためには、組織体制を整えるだけでなく、日々の業務や意思決定の質とスピードを高める仕組みづくりが不可欠です。デジタルトランスフォーメーションの推進、業務プロセスの見直し、サプライチェーン改革、ITアーキテクチャとセキュリティの強化、AI活用の推進などを通じて、より生産性が高く、強靱で、変化に対応しやすいオペレーションへの進化を進めています。

こうした取り組みは、単なる効率化にとどまりません。サプライチェーンのレジリエンス向上、リスク対応力の強化、

コスト競争力の改善、さらには顧客への提供価値の向上にもつながっています。オペレーションの質を高めることは、経営の土台を強くすることであり、企業価値の向上に直結するテーマであると認識しています。

INTEGRITYが支える分散型の意思決定

もっとも、各領域の責任者に権限と責任を委ねる体制は、制度や仕組みだけで機能するものではありません。そこに共通の価値観が伴って初めて、分散された意思決定は組織としての強さになります。当社においてその基盤となっているのが、コア・バリューである「INTEGRITY」です。

INTEGRITYとは、単に誠実であるということにとどまらず、事実に真摯に向き合い、正しいことを正しく行い、透明性をもって判断し、責任を果たす姿勢そのものです。各CxOが明確な責任のもとで意思決定を行い、各地域・各機能が自律的に動く当社の経営において、この価値観は不可欠です。共通の価値観があるからこそ、判断の前提がそろい、組織全体としての一貫性が保たれます。そしてそれが、顧客や社会からの信頼にもつながっています。

当社は創業以来、「計測」を通じて産業や社会の進化を支えてきました。精度を追求し、事実を正しく捉え、その上で価値を生み出すという姿勢は、まさにINTEGRITYと重なります。私は、このDNAがあるからこそ、当社はグローバルに広がる事業体制の中でも、高い実行力と信頼性を両立できているのだと考えています。

未来を見据えて

今後も、当社を取り巻く事業環境は大きく変化していくでしょう。だからこそ私たちは、変化に対応するだけでなく、変化を前提とした経営とオペレーションをさらに磨いていかなければなりません。CxO体制のもとで責任と権限をさらに明確にし、地域・事業・機能の連携をより強固なものにすることで、グローバルオペレーションの実効性を一段と高めていきます。

Group COOとして、私は引き続き、現場に近い迅速な意思決定とグループ全体の力の最大化を両立させながら、より生産性が高く、強靱で、信頼される事業基盤の構築に取り組んでいきます。そして、INTEGRITYを土台に、一人ひとりの実行力を結集することで、持続的な成長と企業価値の向上を推進してまいります。

FY2025 Highlights

1兆1,286億円

売上高（過去最高）

44.2%

営業利益率

営業利益4,991億円（過去最高）

-76%

GHG排出量削減率
（スコープ 1+2、2018年度比）

2倍超

生産能力（2022年比）

7,200人超

グローバル従業員数

3,754億円

当期利益（過去最高）

54.4%

ROIC（投下資本利益率：
Return On Invested Capital）

65%

市場シェア
（CY前年比+7ポイント）

No. 1

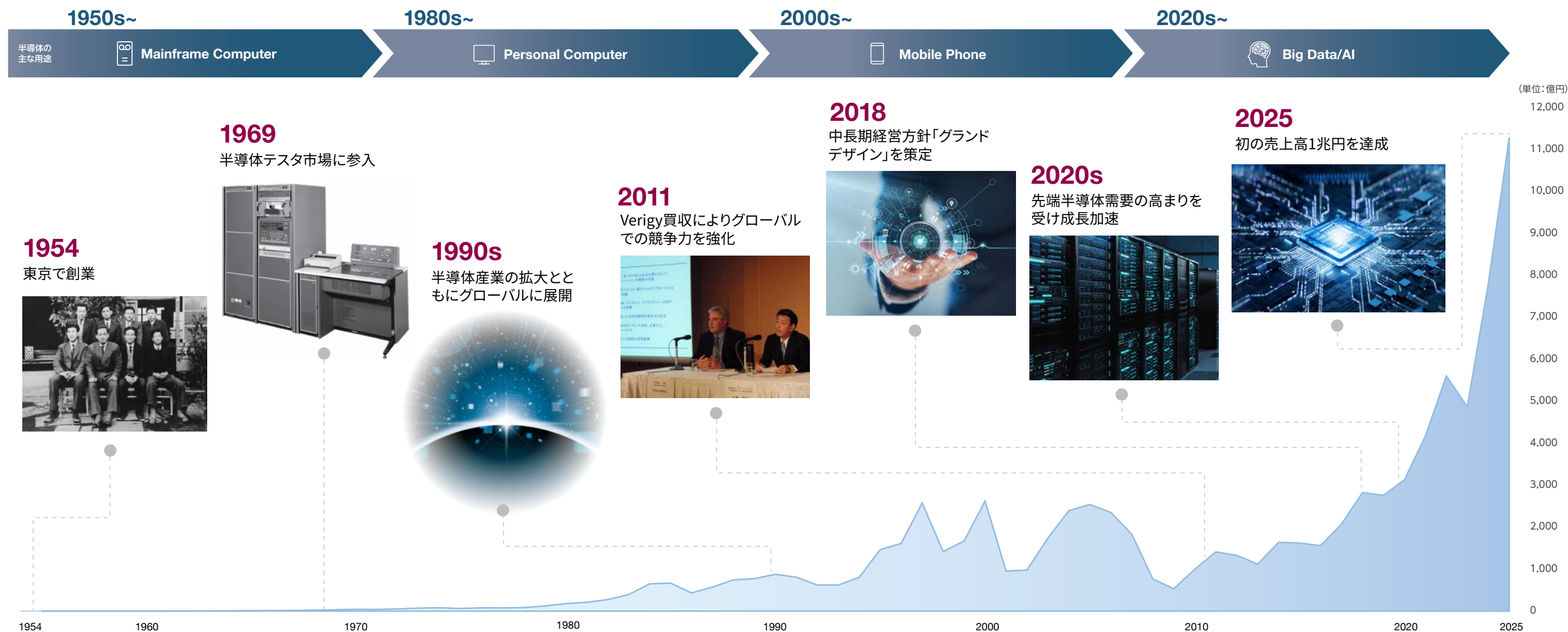
TechInsights社顧客満足度調査

50カ所以上

グローバル拠点数



History



How We Create Value

先端計測技術と統合的なテストソリューションを通じて、顧客の課題解決に貢献

アドバンテストは70年以上にわたり、先端計測技術を通じて顧客のイノベーションを支えてきました。半導体がますます高度化し、社会的役割が拡大する中、テストの重要性も一段と高まっています。テストは、もはや品質を確認するための工程ではありません。半導体の性能向上、信頼性の確保、歩留まりの改善、そして市場投入までの期間短縮を支える、半導体イノベーションに不可欠な役割を担っています。

当社の事業の中心にあるのは、顧客の課題を解決するという姿勢です。私たちは、顧客の技術面・オペレーション面のニーズを深く理解し、それぞれの課題に応じたソリューションを開発し、グローバルに提供・サポートするとともに、信頼に基づく長期的な関係を通じて、顧客とのパートナーシップをさらに深めています。



A 先端計測技術の開発

当社の事業の基盤は、先端計測技術にあります。創業以来、私たちは高精度かつ信頼性の高い計測技術を磨き、先端技術の発展を支えてきました。この技術力は、次世代半導体デバイスに求められる、ますます複雑なテスト要件に対応する上で、当社の重要な強みとなっています。 ▶ P. 25-26 研究開発



B 幅広く統合されたテストソリューションポートフォリオ

当社は、SoC及びメモリ向けテストシステムに加え、テストハンドラ、デバイスインタフェース、システムレベルテスト、インターコネクトソリューション、SEMメトロロジー製品、サポート・サービス、データを活用したソリューションなど、幅広いポートフォリオを有しています。これらの機能を統合することで、顧客ごとのテストフローやデバイス要件に最適化された包括的なソリューションの提供を目指しています。 ▶ P. 15-16 事業セグメント



C 信頼に基づくカスタマーリレーション

継続的で密接な対話を通じて、当社は顧客の現在のニーズ、将来の技術ロードマップ、生産上の優先課題、戦略的課題を理解することに努めています。開発段階から量産、フィールドサポートに至るまで顧客に寄り添い、先端半導体技術の市場投入を支える長期的なパートナーとして顧客を支援しています。 ▶ P. 27-28 顧客関係



D 需要変動への柔軟な生産対応力

当社は、自社工場と外部委託先を組み合わせたハイブリッド生産により、柔軟で拡張性のある供給体制を構築しています。また、主要部品を安定的に確保するため、サプライヤーとの長期的な関係構築にも取り組んでいます。この体制により、需要変動に対応しながら、品質、信頼性、供給継続性を維持しています。 ▶ P. 29-31 サプライチェーンのレジリエンス強化に向けた戦略



E グローバル人財とINTEGRITY

当社の事業の強みを支えているのは人財です。エンジニア、フィールドサービス、営業、サプライチェーン、コーポレート部門など、多様な人財が地域や事業部門を越えて連携し、顧客の課題解決に取り組んでいます。当社のコア・バリューであるINTEGRITYは、意思決定、協働、信頼の共通基盤となっています。 ▶ P. 32-33 人財戦略の実行を支える仕組みと施策

How We Create Value

アドバンテストの価値創造エンジン

当社の事業のコアにあるのは、顧客の課題を解決するという揺るぎない姿勢です。この姿勢が、顧客のニーズを深く理解し、最先端のソリューションを開発し、グローバルに提供・サポートし、顧客からの信頼をさらに深めるという継続的なサイクルを生み出しています。



このサイクルを通じて、アドバンテストは先端半導体デバイスの開発と生産を支えています。当社の役割は、ますます複雑化するテスト要件に顧客が対応できるよう支援するとともに、イノベーションに不可欠なソリューション、グローバルな対応力を通じて、半導体エコシステムを支えることにあります。

このサイクルを通じて生まれる価値

当社は、顧客の製品開発から量産までを通じて、以下のような成果の実現に貢献しています。



品質と信頼性の向上



生産性の向上



歩留まりの改善



市場投入までの期間短縮

当社の事業基盤をさらに磨き上げることで、アドバンテストは、半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテストソリューション・カンパニーであり続けることを目指します。

事業セグメント

アドバンテストの事業セグメントは「テストシステム事業」と「サービス他事業」の2つに大別されます。

主力製品であるテストシステムに周辺機器等を統合したテストソリューションで、半導体デバイスの複雑化に伴う業界ニーズに応えるとともに、さまざまな顧客課題の解決に貢献します。

テストシステム事業

当社の主力製品であるテストシステムに加え、半導体デバイスをテストシステムに搬送するテストハンドラ、デバイスとテストシステムを電氣的に接続するデバイスインタフェース、半導体やモジュールのシステムレベルテストのソリューションが含まれます。

■ テストシステム

主に半導体プロセスのウェーハテスト工程またはファイナルテストの工程で用いられ、大量の半導体デバイスを自動かつ同時にテストします。テストデータからは単なる良品・不良品の判定のみならず、半導体プロセスの改善につながるさまざまな洞察を得ることができます。

半導体は大きく、SoC（システムオンチップ）とメモリに大別され、当社はこの両方に対応するテストシステムを展開しています。

SoC向けのテストシステムでは機能ボードを交換可能なモジュール構造を採用し、さまざまな種類の半導体デバイスに柔軟に対応することが可能です。一方でメモリ向けには、同じ規格のデバイスを一度に大量にテストすることができる専用装置を提供しています。

■ テストハンドラ、デバイスインタフェース

半導体テストにおいては、生産性やスループットを向上させるため、オートメーション化による効率化が鍵となります。これを実現するために、当社ではテストシステムにデバイスを搬送し、デバイスに温度などの試験条件を印加する「テストハンドラ」と、デバイスの仕様や形状に合わせてテストシステムと電氣的に接続する「デバイスインタフェース」を揃えています。当社は、これらのソリューションを統合した「テストセル」をワンストップで提案することができます。

■ システムレベル・テストシステム

半導体デバイスの複雑化が進むにつれて、デバイス単体の試験では良品が保証された場合でも、最終製品に組み込んだ際に不具合が発生するケースが生じています。システムレベル・テストシステムは、最終製品と同様の環境でデバイスをテストすることでテストカバレッジを拡大し、デバイスの品質や信頼性向上に貢献します。



サービス他

顧客へのサポート・サービスの提供、半導体ウェーハ向けSEM及び消耗品販売等で構成されます。

■ サポート・サービス

高度な技術を要する半導体テストにおいてより高い精度と信頼性を実現するため、当社サポートエンジニアが世界各地の拠点から、テストシステムの迅速な立ち上げや稼働率向上など、テストに関わるあらゆる局面をサポートします。

■ 測長SEM/欠陥レビューSEM

半導体ウェーハにパターンを転写する際に用いるフォトマスクの配線パターンを、高精度かつ安定的に測定・レビューする走査型電子顕微鏡（SEM）です。微細な線幅や構造が要求される先端デバイスのプロセスで活用されています。

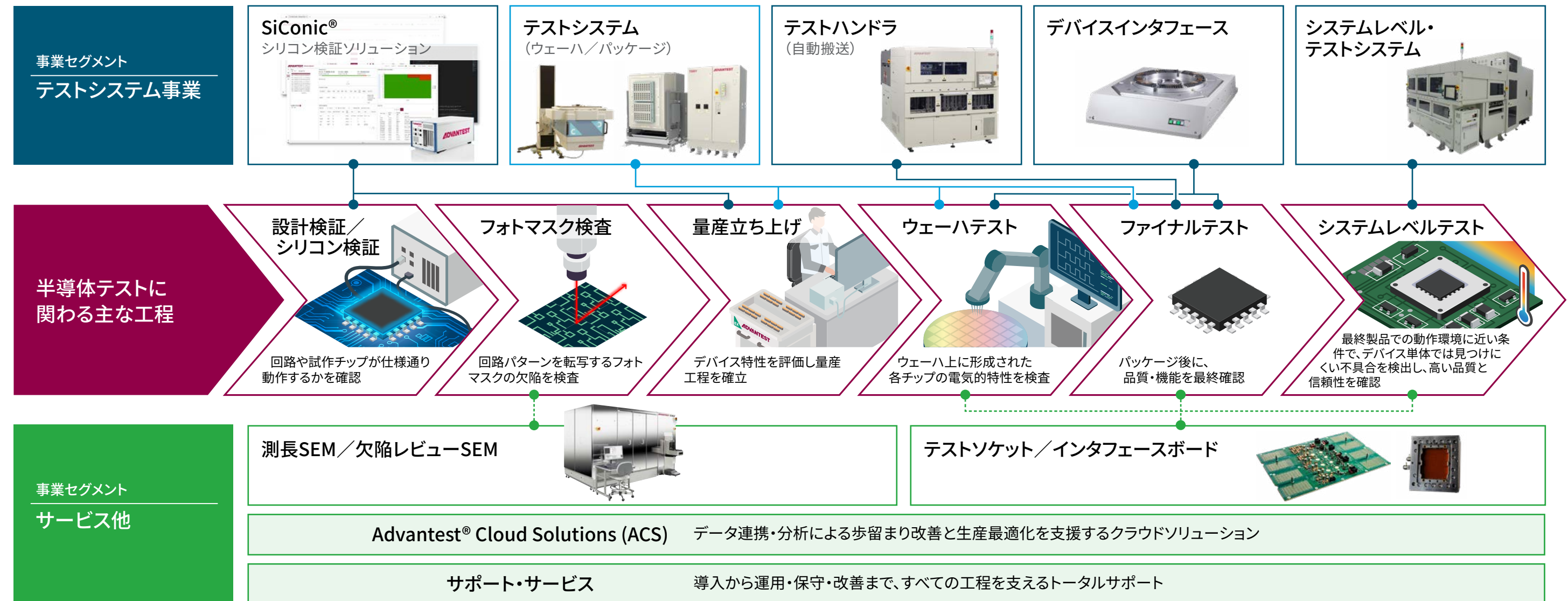
■ Advantest Interconnect Solutions™

2020年に買収したEssai社と、2021年に買収したR&D Altanova社のソリューションを統合した新たな製品ユニットです。高性能・高密度デバイス向けインタフェースボード、サブストレート、ソケット、サーマルコントローラ・ユニットを当社のテストシステムと組み合わせることで、テストシステムからテストデバイス端のトータルソリューションをさらに拡充します。

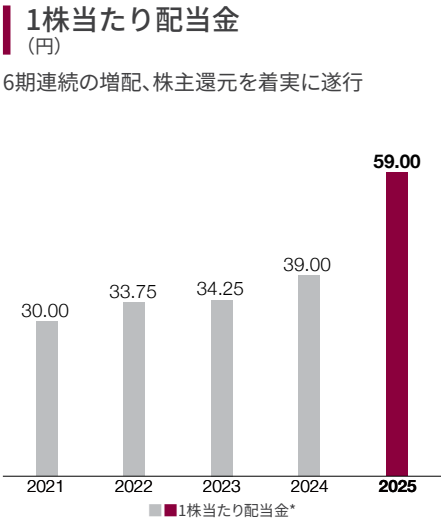
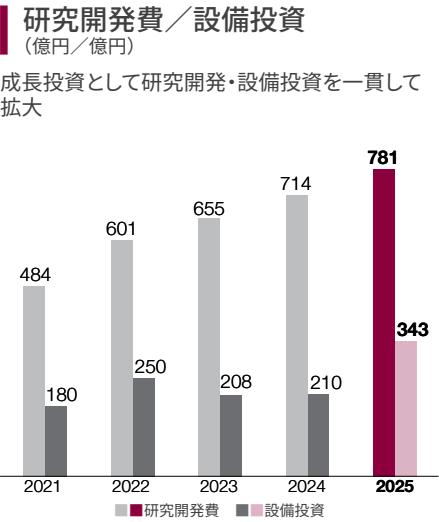
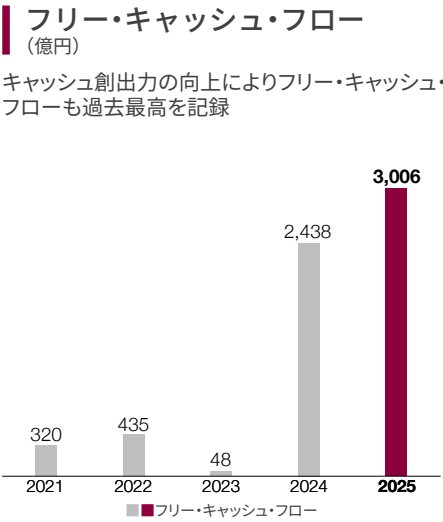
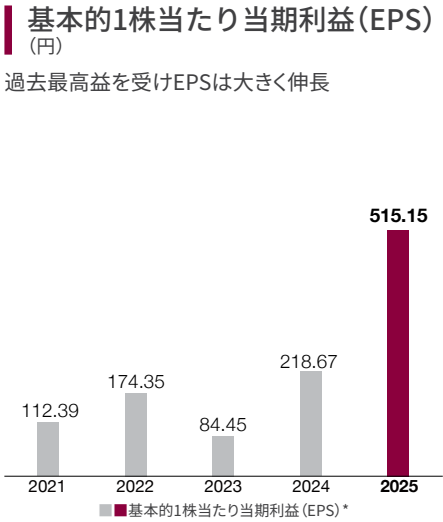
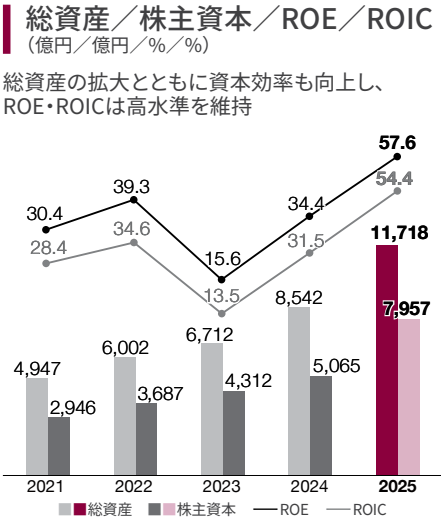
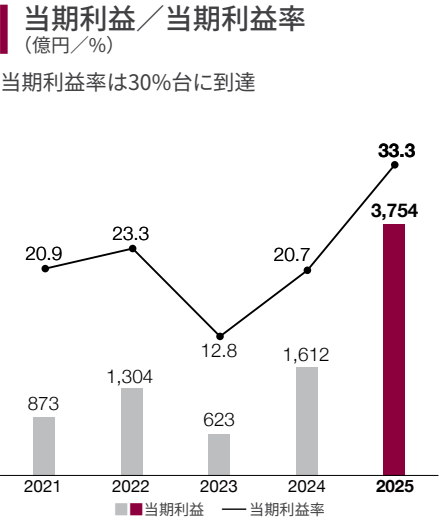
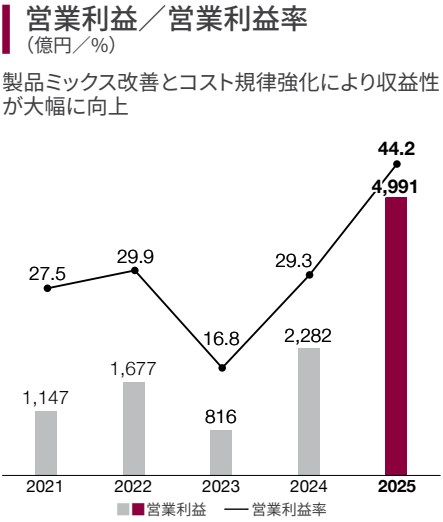
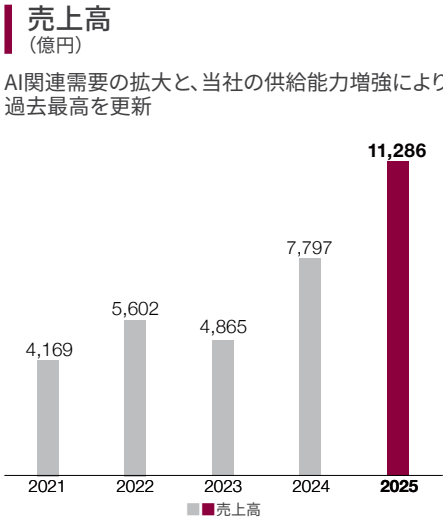
事業セグメント

半導体の進化と品質を支えるアドバンテストのテストソリューション

半導体の開発・製造プロセスにおける主なテスト工程と、当社の製品・ソリューションの位置付け



連結財務ハイライト (4月1日から始まる各会計年度)



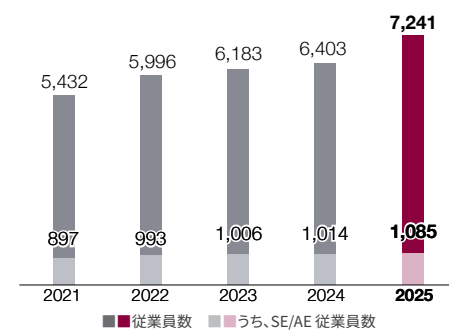
*当社は、2023年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。上記基本的1株当たり当期利益 (EPS) は2021年度期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しています。

*当社は、2023年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。上記1株当たり配当金は2021年度期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しています。

連結非財務ハイライト (4月1日から始まる各会計年度)

従業員数*1／SE*2／AE*3従業員数 (人)

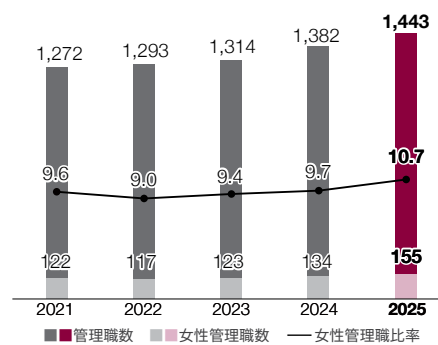
今後のビジネス拡大を見込み
人的資本への投資を継続



*1 臨時従業員を含みます。
*2 システムエンジニア
*3 アプリケーションエンジニア

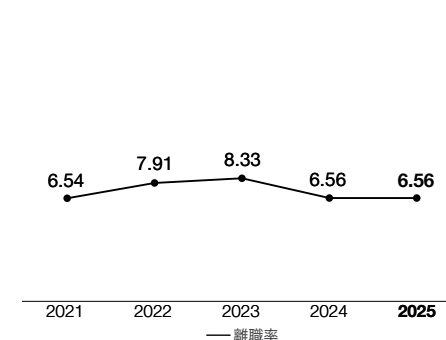
管理職数／女性管理職比率 (人／%)

女性管理職は確実に増加



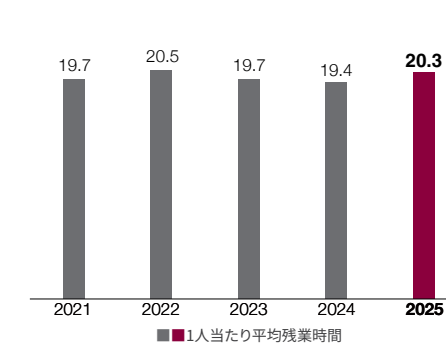
離職率 (%)

労働市場全体で離職率の高い生産部門を
持つ北米企業を2021年に買収



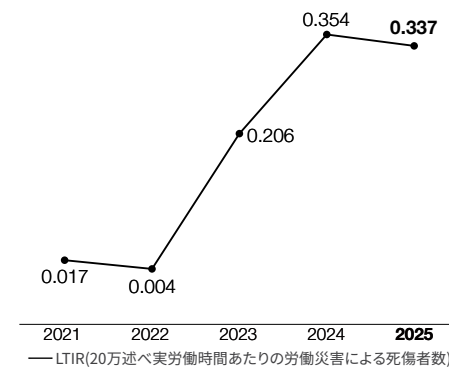
1人当たり平均残業時間 (日本・中国・韓国) (時間／月)

業容の大幅拡大もあり前年度比微増



労働災害発生率(LTIR:グローバル) (人)

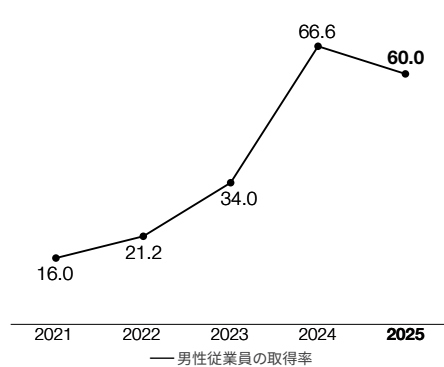
各拠点から持ち寄った安全課題を継続的に協議
し、職場環境改善を推進する。



— LTIR(20万述べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数)

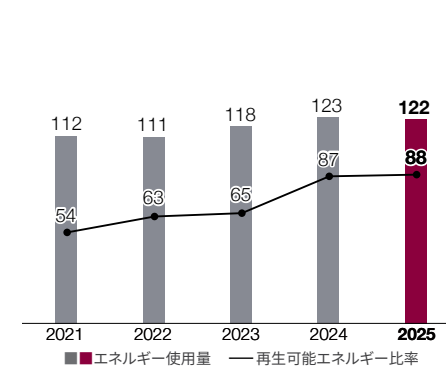
男性社員育児休業取得率(日本) (%)

育児参加への意識が男性社員に定着



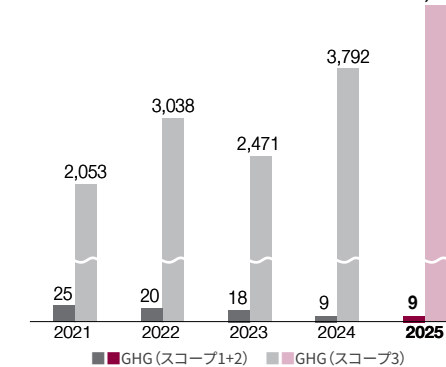
エネルギー使用量／ 再生可能エネルギー比率 (GWh／%)

サステナビリティ行動計画の
2026年度目標値80%を前倒しで達成



GHG(スコープ1+2／スコープ3) 排出量 (kt-CO₂)

テスト生産高に比例してGHG(スコープ3)の
排出量も増加





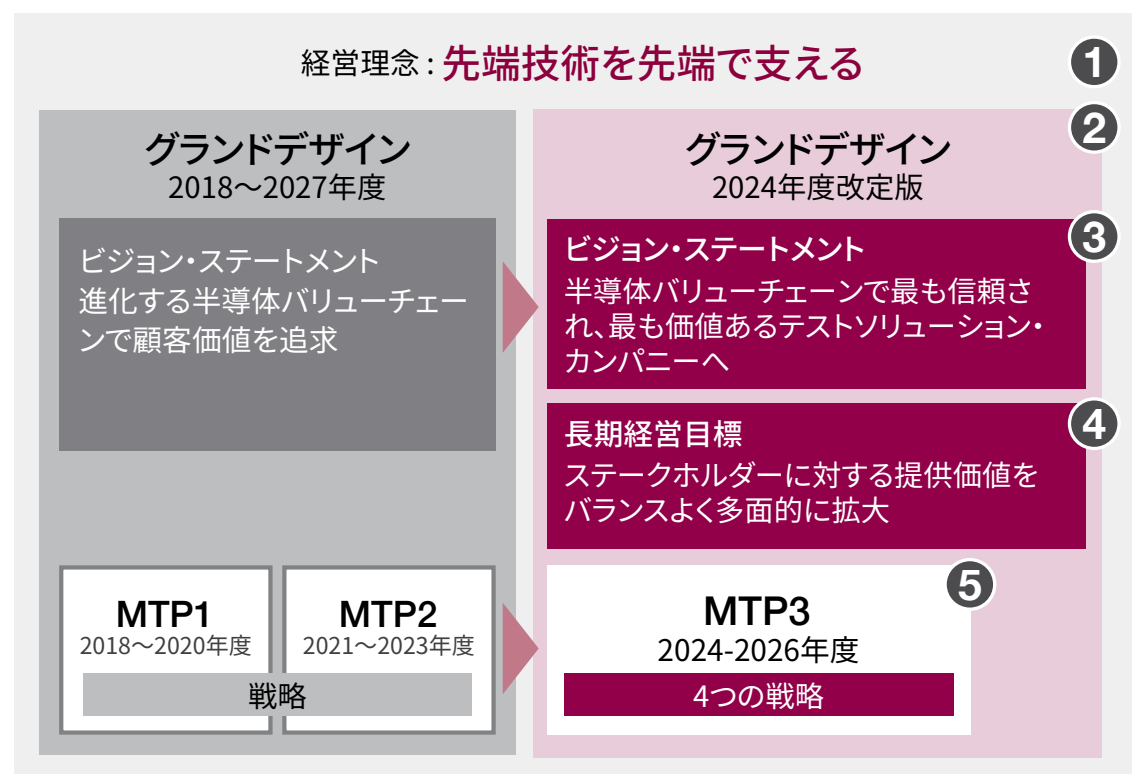
Strategy

中長期経営方針「グランドデザイン」	20
第3期中期経営計画（MTP3、2024～2026年度）の概要	21
CFOメッセージ	23
研究開発	25
顧客関係	27
サプライチェーンの拡張性とレジリエンス強化に向けた戦略	29
人財戦略の実行を支える仕組みと施策	32
リスクマネジメント	34

中長期経営方針「グランドデザイン」

当社の経営理念は「先端技術を先端で支える」です。この経営理念を体現する会社であり続けるため、当社がどうありたいか、何をなすべきかを定めたものが中長期経営方針「グランドデザイン」です。2018年度に初めて策定し、2024年には最新の事業環境見通しをもとに改定を行いました。

グランドデザインのもとに3年間の中期経営計画を位置付け、現在は第3期中期経営計画に取り組んでいます。



当社の中長期経営方針の構成

① 経営理念

1990年以来常に掲げ続けている、私たちの存在意義です。私たちは世界中の顧客にご満足いただける製品・サービスを提供するため、たえず自己研鑽に励み、最先端の技術開発を通して社会の発展に貢献していきます。

② グランドデザイン

経営理念を体現する会社であり続けるため、長期的にどうありたいか、そしてそのために何をなすべきかを定めた中長期経営方針です。全世界の従業員が一丸となって顧客価値創造と企業価値向上に取り組むための共通の経営目標です。

③ ビジョン・ステートメント

「半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテストソリューション・カンパニーへ」

当社グループが将来どのような姿になりたいかを示すものです。当社グループは、提供価値の拡大を通じ、すべてのステークホルダーにとり、半導体バリューチェーンで最も信頼でき、最も価値あるテストソリューション・カンパニーとなることを目指します。半導体テス

タというハードウェア製品を顧客に販売するのみではなく、より複雑化する半導体試験に効率よくアプローチできる半導体テストソリューションという新たな価値を提供し、半導体バリューチェーン全体にとって不可欠な企業となることを目指します。

④ 長期経営目標

当社グループの経営における長期的な目標です。当社グループは、顧客課題の解決を軸としながら、サステナブルな社会実現につながる各種取り組みを今後一体的に推進します。そして同時に、当社グループを取り巻く各ステークホルダーの期待や要請を事業活動に適切に反映していくことで、当社グループの存在意義や提供価値を経済的にも社会的にもバランスよく、かつ多面的に拡大することを目指します。

⑤ 中期経営計画

グランドデザインで描いたありたい姿の実現に向けた取り組みと数値目標を具体的に定めた3年間の経営計画です。これまでに二つの中期経営計画を遂行し、2024年度からの新たな3年間にに向けた「MTP3」を2024年6月に制定し、現在取り組みを進めています。



第3期中期経営計画（MTP3、2024～2026年度）の概要

半導体テスト関連市場は、短期的なダウンサイクルを織り込みつつも、中長期的に成長を続けると見込んでいます。また半導体市場の拡大に加え、半導体の複雑性への対応が業界における構造課題となる中で、当社グループの事業機会は中長期的に拡大するものと考えています。

このような環境のもと、当社グループは、改定した「グランドデザイン」に則り策定した、第3期となる3か年中期経営計画（MTP3）を2024年度より展開しています。

MTP3で掲げた各戦略施策については、「Automation of Test」の提供実現に向けた取り組みや、その基盤となる業界内エコシステムの構築を筆頭に、総じて想定を上回る進捗と認識しています。MTP3の最終年度となる2026年度は、中長期的な企業価値向上に向けた各種の取り組みを引き続き推進いたします。

MTP3の4つの戦略：狙いと2025年度の成果

1 コア市場の成長率を上回る成長実現

当社グループの今後のコア市場においては、半導体の生産量増加、半導体の高性能化、そして半導体の複雑性進行への対応が重要な成長機会となると想定しています。これに対しては、個々のテストソリューションの性能向上に加え、顧客に「Automation of Test」、すなわち半導体テストの効率性向上をもたらす新たな価値を、当社グループが擁する多様な製品・ソリューション群の有機的な結合や社外パートナーとの連携などを通じて創造します。これらにより、市場成長率を上回る事業成長を引き続き実現することを目指します。

2025年度取り組み成果

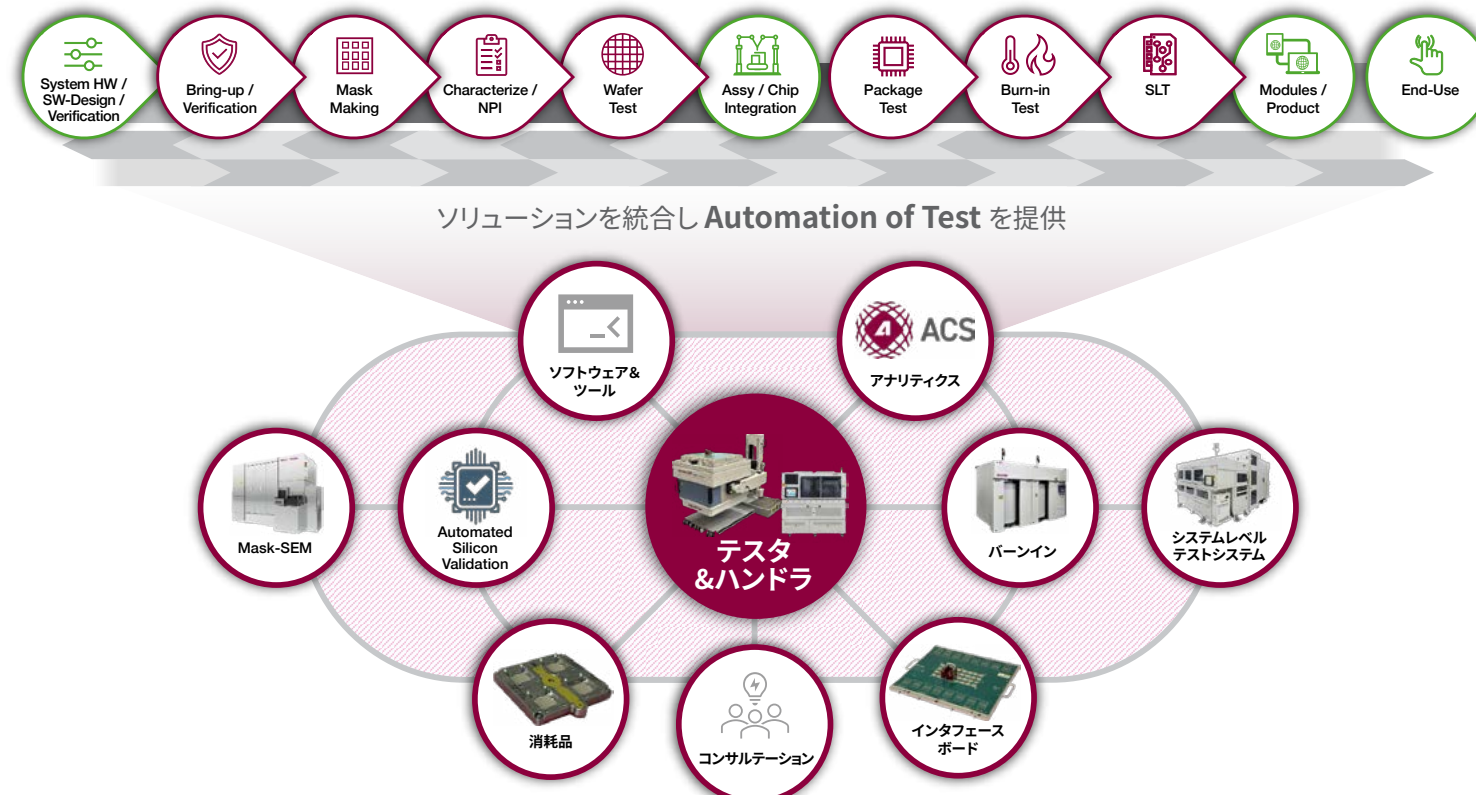
- テスト需要の変化を先読みした顧客訴求力ある製品の拡販や重点顧客・地域戦略を通じ、半導体テスト市場における市場シェアをさらに拡大（市場シェア：暦年2024年 58%、暦年2025年 65%）
- 複数の次世代テストソリューションを新たに展開
- 中長期的な業界課題の解決に向け、研究開発体制を充実。また、次世代DRAM向けやシリコンフォトリソグラフィ向けなど今後期待の高い領域における高付加価値テストソリューションの市場投入準備が進捗。シリコンフォトリソグラフィは大規模量産向け用途で初受注

2 近縁市場・新規事業領域への展開

半導体の高性能化や複雑性が進行する中では、より広く、統合されたテストソリューションが望まれます。当社グループはこれまでもシステムレベルテストやテスト周辺機器への事業展開を進めてきましたが、今後もこのアプローチを継続することで顧客への提供価値をさらに拡大します。具体的には、当社製品のインストールベースを活用したフィールド・サービスやAdvantest® Cloud Solutionsの販促に取り組むほか、当社の近縁市場における顧客価値向上に向けた新規の取り組みを通じた事業機会創生にも挑戦します。

2025年度取り組み成果

- シリコン検証を自動化する画期的なソリューション「SiConic®」の業界内認知が拡大
- テスト価値のさらなる創出に向け、「Advantest Innovation Center」の開設や、Applied Materials, Inc.社のEPIC(Equipment and Process Innovation and Commercialization) プラットフォームへの参画など、業界横断的な協働の取り組みを拡充
- 顧客の将来のニーズに応える高性能トータルテストソリューション実現に向けて、プローブカードメーカー3社との戦略パートナーシップを深耕



第3期中期経営計画 (MTP3、2024～2026年度) の概要

3 オペレーショナル・エクセレンスへの取り組みを推進

当社グループは、技術、ノウハウ、リソースの活用を部門横断的に進めることで、半導体業界におけるテスト課題を解決していきます。また、当社グループのステークホルダーすべてにとって価値がある企業となるためには、製品や技術面の優秀さだけでなく、あらゆるオペレーションの効率性と有効性を高めていく必要があると認識しています。それに向け、DXを通じた社内オペレーションの迅速化と省人化、強靱なサプライチェーンの構築、有能人財の登用や社員教育の拡充などによる人的資本強化、AIやデータ・アナリティクスを活用した社内生産性向上などに取り組みます。

2025年度取り組み成果

- 先駆的なサプライチェーン管理高度化とサプライヤーとの強固な協業を通じ、急峻な製品需要の伸びに追従
- 業務の迅速化と効率向上に向け、ガバナンスを確保したAI利活用を本格化
- 今後の成長実現に向け、人財採用・育成・定着力の強化と魅力あふれる職場づくりを推進

4 サステナビリティの取り組み強化

気候変動や人権問題をはじめとするサステナビリティ課題に対する能動的かつ積極的なアクション、法令遵守や企業倫理の徹底を含めた責任ある事業活動の遂行、リスクマネジメントの強化やコーポレートガバナンスの高度化などを通じて企業価値向上基盤をさらに強化するとともに、各ステークホルダーからより厚い信頼を得られるよう努めます。またサステナビリティに関する取り組みの推進にあたっては、その根源となるものは企業内の共通カルチャーや価値観であることから、これらの醸成と浸透にも努めます。

2025年度取り組み成果

- 事業規模が拡大する中でも、GHG排出量(スコープ1+2)を前年度実績と同等水準に抑制
- 半導体業界に精通し、かつ高度な専門的知見と経験を有する多彩な人財を幹部として複数登用することで、当社グループの経営執行能力を強化するとともに事業環境の複雑化に対応

経営指標

MTP3では、4つの戦略を通じて収益拡大、収益性改善、資本効率向上を図ることで、企業価値の向上に取り組めます。これに沿い、MTP3において重視する経営指標を売上高、営業利益率、当期利益、投下資本利益率(ROIC)、基本的1株当たり当期利益(EPS)とし、これらの向上に努めます。各指標の進捗を中長期視点で評価するため、下記の経営指標は、市場変動の影響を平準化できる3か年平均の値を用いています。

なお2025年10月、AI/HPC半導体のテスト需要が想定した以上に力強く推移する見通しとなったこと、及び市場シェア拡大等の社内戦略施策の進捗を踏まえ、2024年6月に公表した当初の内容から全指標を上方修正しています。

	MTP3(2024～2026年度) 平均目標*1	2024年度実績*2	2025年度実績*2
売上高	8,350～9,300億円	7,797億円	11,286億円
営業利益率	33～36%	29.3%	44.2%
当期利益	2,070～2,480億円	1,612億円	3,754億円
投下資本利益率*3(ROIC)	34～39%	31.5%	54.4%
基本的1株当たり当期利益(EPS)	284～341円	218.67円	515.15円

*1 2025年10月時点での修正値。修正値は、2024年度及び2025年度上期の実績値に、その時点における2025年度下期及び2026年度の業績予想を加味したもの。前提とした為替レートは1米ドル=140円、1ユーロ=155円。

*2 2024年度の為替レート実績は1米ドル=153円、1ユーロ=164円。2025年度の為替レート実績は1米ドル=150円、1ユーロ=173円。

*3 投下資本利益率: NOPAT ÷ 投下資本(期首・期末平均)。NOPAT: 営業利益 × (1 - 税負担率25%)。投下資本: 借入金 + 社債 + 資本合計(リース負債含まず)。

2025年10月に実施したMTP3のアップデート内容の詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。



CFO メッセージ



高田 寿子
経営執行役員
Chief Financial Officer (CFO)

CFO就任から1年を振り返って

私がアドバンテストに入社しCFOに就任してから1年が経ちました。この1年を通して当社が向き合うべき経営課題の一つとして強く認識したのは、半導体業界に特有の高いボラティリティです。売上や利益に加え、株価も大きく変動します。こうした変動に備えるためには、将来の急激な需要増に対応するバッファー在庫の確保や、バランスシートの流動性と安定性の維持が必要となります。一方で、それらはさまざまなコストの上昇を伴うため、資本効率とのバランスが求め

られます。財務の安定性を確保しながら、いかに効率性を高めていくか。その両立が、当社にとって極めて重要な経営課題であると認識しました。

こうした課題について、この1年間、取締役会も含めた議論を重ねてきました。例えば棚卸資産については、必要となるバッファーの水準とその考え方を明確にした上で定期的に見直し、適正水準を超えた場合には速やかに対策を講じるという、基本的な枠組みと方針を定めました。また、1年間にわたる自己株式購入のプログラムを完了するなど、資本構成や資本残高も含めたバランスシート全体の適正化にも取り組んでいます。

足元の具体的な取り組み

「適正化」という言葉からは単なる「調整」を想起されるかもしれませんが、しかし、現在の良好な市場環境を踏まえれば、当社は現在成長投資と株主還元の両面に対応していくべき局面にあると考えています。特に、半導体市場特有の需要変動への対応や、機を捉えた戦略投資の実施は、短期的な事業機会を捉えるだけでなく、当社の持続的な成長を確かなものにするために欠かせません。現在、こうした判断を機動的かつ規律ある形で行うための枠組みを整備しています。

具体的には、以下の3点です。

- ・在庫水準や流動性の適正水準設定
- ・資本効率と財務安定性のバランス管理
- ・市況変動を前提としたシナリオベースの経営判断

これらの取り組みにより、変動を前提としながら必要な戦略投資を着実に実行することで、中長期的に安定した財務基盤を維持する方針としています。

近年、当社では利益率やROEといった指標が高水準で推移し、売上高も大きく成長してきました。その結果、2025年度には総資産が初めて1兆円を超え、総資産や資本の規模から見ても、新たな成長段階に入りつつあります。この点

は、2026年7月に格付投資情報センター（R&I）による当社の発行体格付が「A+」から「AA-」へと引き上げられた際にも、評価要素の一つとなったと認識しています。近年の好調な業績が当社の財務健全性をより高め、将来の成長に向けた積極的な投資を可能としている状況にあります。

転換社債発行

2026年4月、当社は1,000億円の転換社債を発行しました。その背景には大きく三つの考えがあります。

1. 将来のさらなる需要増に対する迅速な備え

調達資金のうち、700億円を生産能力の拡大と在庫の確保に充当する予定です。中長期的な需要拡大を見据える中で、顧客が要求する製品を当社が提供できなければ、当社自身が半導体市場成長のボトルネックになってしまう、といった可能性も考えられる状況です。半導体市場の健全な発展を支え、当社の競争力を維持・強化するためにも、必要な資金をあらかじめ確保し、迅速に投資を実行することが重要であると判断しました。

2. 負債活用

半導体セクターは業績の変動幅が大きく、多額の負債による財務レバレッジを恒常的に活用することには慎重であるべき業界であると考えています。一方で、当社は近年の好業績によって財務健全性が大きく向上し、負債を活用できる余地が生まれました。資金調達にあたっては、社債や銀行借入も比較検討しましたが、現在のような金利が上昇する局面において、ゼロクーポンでの調達が可能な転換社債の特性は、その選択を決定づける重要な要因となりました。また、発行金額は当社の時価総額に対して限定的な水準ではあるものの、資本構成に転換社債を入れることで、資本コストの低減が期待できるという点も考慮しました。



CFO メッセージ

3. 上昇した株価の有効活用

転換社債を選択したもう一つの大きな理由は、市場からの高い期待を背景に株価が上昇し、仮にすべてが株式に転換された場合でも希薄化率を極めて低い水準に抑えられる環境にあったことです。2014年に発行した転換社債は全額が株式に転換され、発行時に想定された希薄化率は8.3%でした。これに対し、今回は0.4%程度にとどまる見通しであり、既存の株主の皆さまへの影響を限定的な水準に抑えることができたと考えています。さらに、転換制限条項を付与することで、短期間のうちに希薄化が生じにくい設計としました。

当社株式はボラティリティが高いことから、アップ率※も60%という高い水準になりました。それにもかかわらず、投資家からは発行額の約8倍に相当する需要があったと聞いており、当社の将来に対する市場の大きな期待を改めて感じています。

業績も好調でキャッシュ・フローも良好な状況にはありましたが、タイムリーな成長投資や株主還元など、今後も旺盛な資金需要が見込まれます。今回の転換社債の発行はそうした将来の選択肢を確保し、財務戦略の柔軟性を高めるための調達となりました。

※アップ率(%) = (転換価格 ÷ 発行時点株価 - 1) × 100

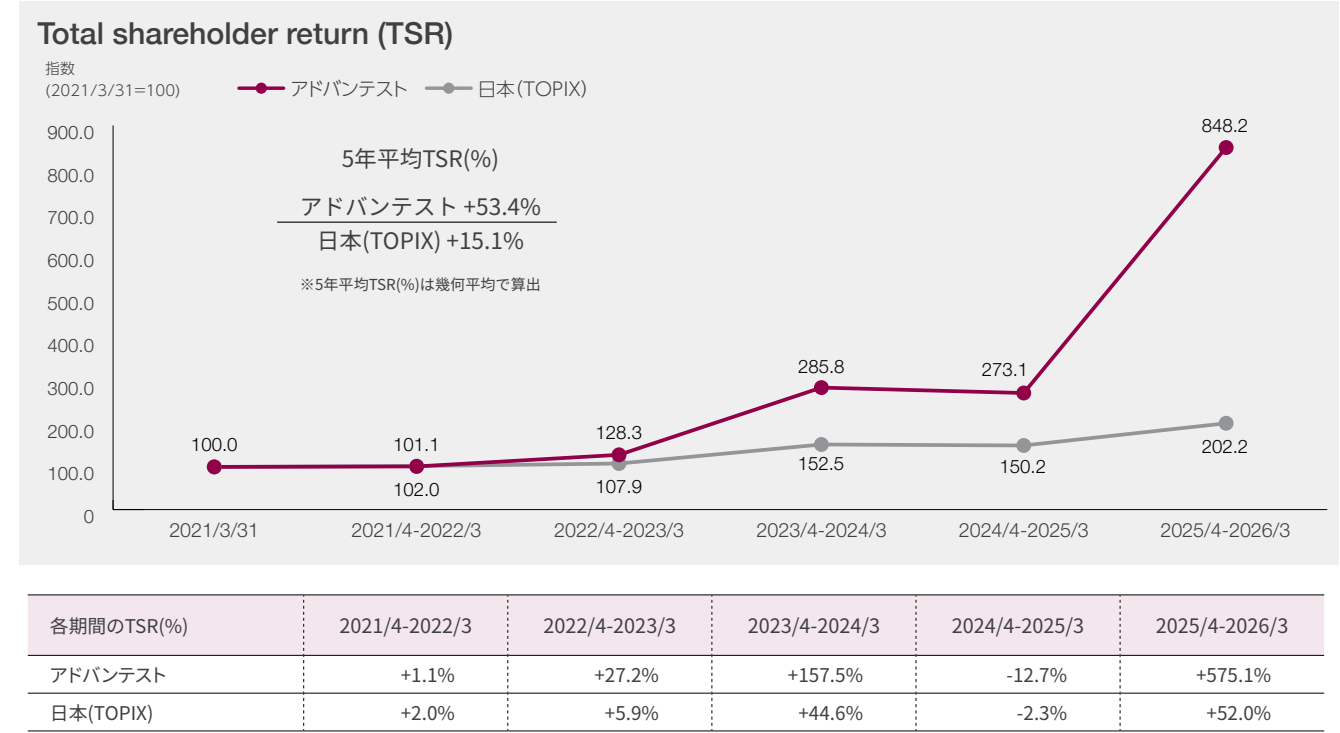
有価証券報告書兼事業報告書の発行

2026年6月26日、当社は有価証券報告書兼事業報告書を開示しました。日本企業として初めての取り組みであったと認識しております。当社は、4年前から有価証券報告書を株主総会前に開示してきました。しかし、監査プロセスに加え、従来から実施している英文翻訳版の同時発行などを考慮すると、株主総会の2営業日前での開示が実務上の限界でした。

こうした中、当社は昨年の株主総会で定款を変更し、株主総会を7月に開催できる体制を整えました。これにより、株主の皆さまが議決権を行使する前に有価証券報告書を十分にお読みいただける時間を確保することが可能となりました。さらに、有価証券報告書と事業報告書の一体開示について、担当部門から次のような提案がありました。

「初年度は大変になるだろうが、一度作成できれば翌年以降は二重作業になる部分を解消して効率的になる。オペレーショナル・エクセレンスを体現するためにも、是非挑戦させてほしい」

この前向きな声を受け、会社として一体開示に取り組むことを決めました。実現に向けては、社内の各部署のみならず、金融庁や法務省などの規制当局、開示支援会社、監査法人など、社外関係者とも勉強会を重ねながら緊密にコミュニケーションを図りました。前例がないからこそ生じる課題を一つひとつ整理し、関係者の知見と協力を得ながら発行にこぎ着けることができました。今回の発行を一つの到達点とするのではなく、投資家をはじめとする皆さまに、より有用で分かりやすい情報をお届けできるよう、引き続き改善を重ねてまいります。



※TSRの株価は、2021年3月31日から2026年3月31日までの期末指数データを使用



研究開発

グローバルな連携で次世代のテスト課題を先読みする

アドバンテストの先端計測技術は、蓄積された技術的専門性と、顧客の技術ロードマップが緊密に連動するグローバルな研究開発体制によって支えられています。半導体デバイスがますます高度化・複雑化する中、テストに求められる精度、性能、対応領域、スピード、効率性は拡大し続けています。当社の役割は、こうした変化を先取りし、半導体バリューチェーン全体で顧客が直面する複雑な課題に対応するためのソリューションを開発することにあります。



イノベーションを支える統合的な開発アプローチ

半導体アーキテクチャが進化する中、テスト課題は単一のデバイス、プロセス、またはテスト工程に限定されるものではなくなっています。チップレット、先端パッケージング、HBM、シリコンフォトニクスなどの技術は、熱特性、信号品質、電力管理、データ量、システムレベルの性能にまたがる新たな要件を生み出しています。こうした課題に対応するためには、複数の技術的視点を組み合わせ、複雑化する顧客要求に応えるソリューションを統合的に開発していくことが重要です。

同時に、半導体業界における変化のスピードは加速し続けており、開発サイクルの短縮がこれまで以上に重要になっています。当社は、高度な開発ツール、並行開発、先行技術開発などの取り組みを通じて、市場機会を的確に捉える力を強化しています。

顧客起点の研究開発を通じた価値提供

顧客ニーズと将来の技術トレンドに密接に結び付いた研究開発を通じて、当社は、当社事業の基盤となる計測技術と統合的なテスト能力を継続的に強化しています。こうした取り組みにより、当社は先端半導体デバイスの開発と生産を支え、半導体エコシステム全体のイノベーションに貢献しています。



研究開発

開発拠点間のグローバルな連携



当社の研究開発における強みの一つは、ドイツ・ボブリンゲンと日本・群馬県にある主要開発拠点の連携にあります。両拠点は、それぞれ異なる専門性、経験、製品開発力を有しています。それぞれの相互補完的な強みを生かし、緊密に連携することで、当社は地域を越えて、各拠点が蓄積してきた技術力と開発リソースを一体的に活用することができます。また、この連携により早い段階からの専門的知見の共有やより効率的な並行開発が可能になり、開発サイクルの短縮にもつながっています。

部門横断的な連携



当社の研究開発の強みは、ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション、プロダクトエンジニアリング、顧客対応チームにまたがる部門横断的な連携にあります。こうした連携により、顧客のニーズを早期に開発プロセスに取り込み、多様な技術的知見を生かすことで、顧客に長期的な価値をもたらす統合ソリューションの創出へとつなげています。



アドバンテストの研究開発は、高度な計測技術に関する深い専門性と、顧客の将来の技術ロードマップに緊密に連動するグローバルな開発体制を基盤としています。半導体業界の変化がこれまで以上に加速する中、市場投入の適切なタイミングを逃さず、技術の進化に対応するためには、開発サイクルの短縮が不可欠です。そのために、私たちは高度な開発ツールを活用し、並行開発、先行技術開発、そしてグローバル開発拠点間の連携を推進しています。私たちはこうした取り組みを通じて次世代のテスト課題を先取りしたソリューションを創出し、最先端の半導体をいち早く世の中に届けようとする顧客の取り組みをサポートしています。”

ユルゲン ゼラー

経営執行役員
Chief Technology Officer(CTO)

顧客関係

顧客との密接なエンゲージメントを通じて信頼を築く

顧客との信頼関係は、アドバンテストの事業の重要な基盤です。技術、市場環境、顧客要件が急速に変化する半導体業界において、カスタマーリレーションは、単に製品を紹介したり、目の前の需要に対応したりする活動にとどまりません。顧客の技術ロードマップ、生産上の優先課題、ビジネスモデル、戦略的課題を早期に理解するための重要な活動です。



顧客の現在と将来のニーズを理解する

当社は、半導体デバイスの複雑化に伴い顧客が直面する課題を理解するため、世界中の主要な半導体企業と密接に連携しています。当社の顧客基盤は、ファブレス企業、IDM、ファウンドリー、OSATなど、半導体バリューチェーン全体に広がっています。こうした幅広い顧客接点により、当社は設計、製造、組立、パッケージング、テストに至る多様な要件を理解し、半導体エコシステムのさまざまな領域で生じる課題に対応するソリューションを提供しています。

特に、当社はAI及びHPC関連の半導体イノベーションを牽引するリーディング顧客と強固な関係を築いています。AIデバイスがますます複雑化し、求められる性能が高まる中、これらの顧客が求めているのは、テストシステム単体ではありません。テスト内容、デバイス・ハンドリング、熱・電力課題、量産立ち上げ、供給対応力、フィールドサポート、データを活用した改善など、幅広い領域にわたる総合的な専門性が求められています。

顧客との継続的で密接な対話を通じて、当社は、顧客が現在必要としているものだけでなく、将来必要とするものを理解することに努めています。こうした顧客エンゲージメントにより、新たな要件を早期に把握し、顧客の長期的な技術・事業上の優先課題に沿ったソリューションを提供することが可能になります。

長期的なパートナーとして信頼を深める

長期的な信頼関係により、当社は現在のプロジェクトだけでなく、将来の機会についても顧客と対話することができます。業界をリードする顧客との密接な関係を維持し、技術や市場の変化を把握することで、当社は新たなニーズを早期に捉え、戦略的なパートナーとして顧客を支援することができます。

信頼に基づくカスタマーリレーションを通じて、当社は顧客課題を解決する力を高め、半導体イノベーションを支え、半導体バリューチェーンにおける役割をさらに拡大していきます。

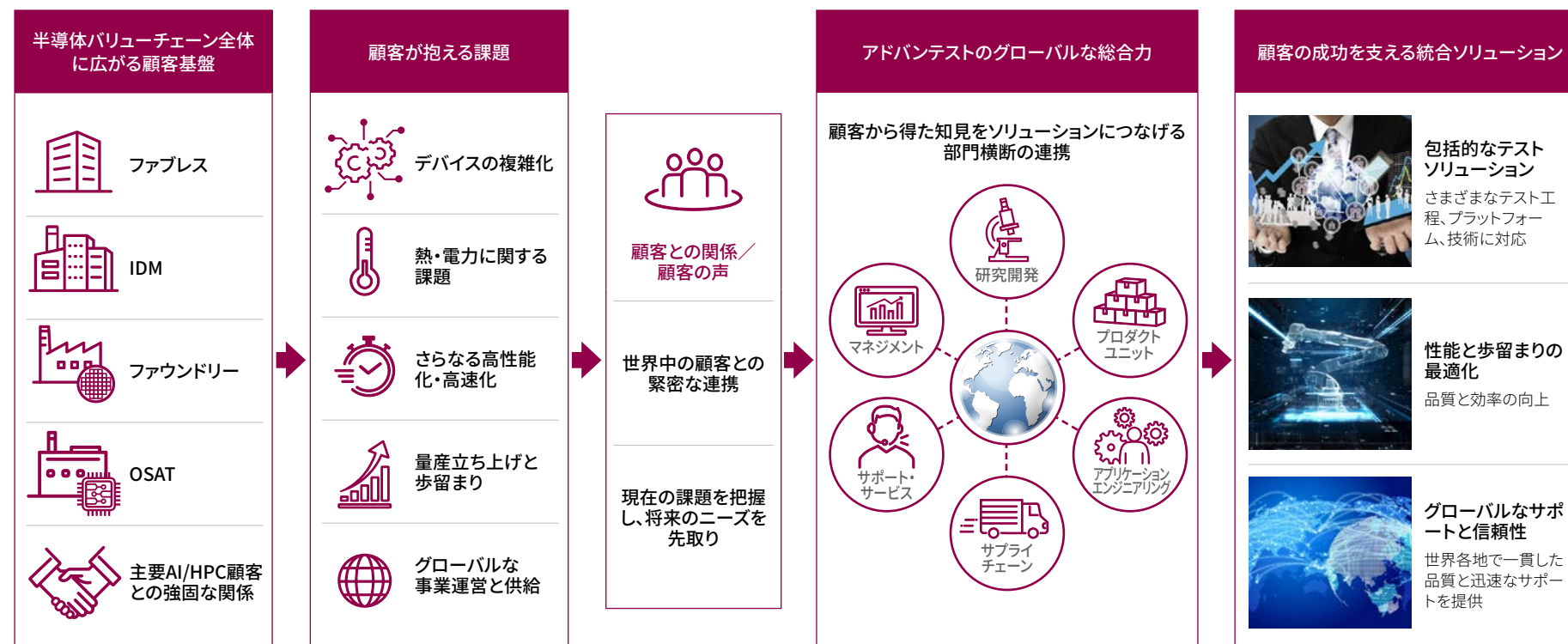


顧客関係

顧客課題をアドバンテストのグローバルな連携力につなげる

カスタマーリレーションの重要な役割の一つは、顧客の声を社内の各機能に橋渡しし、当社のグローバルな連携力につなげることです。顧客との密接な対話を通じて、当社は顧客の技術ロードマップ、生産上の優先課題、新たに生まれる課題を把握します。これらの知見は、研究開発、アプリケーション・エンジニアリング、サプライチェーン、サポート・サービスなど、社内の各機能に共有されます。

顧客と社内組織をつなぐ橋渡し役を担うことで、当社の顧客接点チームは、顧客要件がソリューション開発や事業遂行に反映されるよう支援しています。このクロスファンクショナルなアプローチにより、当社は、各機能の専門性を結集した統合的なソリューションで、ますます複雑化する顧客課題に対応しています。



“

信頼は、継続的な対話を通して、顧客が目指す方向を深く理解することから生まれます。当社は顧客の技術開発の初期段階から関わることで、新たなニーズを先取りし、アドバンテストのグローバルな技術、ソリューションにつなげています。これにより、現在顧客が抱える課題の解決に貢献するとともに、次世代の半導体イノベーションに向けた長期的なパートナーとして顧客を支援しています。”

サンジーヴ モーハン

経営執行役員
Chief Customer Relations Officer (CCRO)

サプライチェーンの拡張性とレジリエンス強化に向けた戦略

将来の成長を支え、競争力強化を実現するサプライチェーン高度化戦略

2025年度は、AI関連の高性能半導体向けテスト需要が大幅に拡大し、過去最高の売上高を記録しました。当社は需要が具体化する以前より、中長期の成長トレンドを見据えて先行的に供給能力を増強してきました。こうした備えが、急速な需要拡大局面における着実な供給につながったと考えています。

半導体バリューチェーン全体の複雑化が進む中で、当社が関係を深めている顧客数は増加しており、当社の製品供給能力の重要性は一層高まっています。このような環境下において、顧客需要を捉え、必要なタイミングで製品を確実に出荷できること自体が競争優位となるという認識のもと、当社サプライチェーンの供給能力とスケーラビリティ（拡張性）の継続的な強化に取り組んでいます。

2025年度の成果として私が特に誇りに思う取り組みの一つが、当社のサプライチェーンにおけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進です。当社は、業務プロセスそのものを見直し、デジタル技術を活用して意思決定の速度と実効性を高めています。

特にハイライトすべき取り組みとして、先進的なS&OP（Sales and Operations Planning：販売・操業計画）及び戦略的なシナリオプランニングの継続的な導入に加え、当社の「Just in Case」戦略を支える在庫管理の強化が挙げられます。

これらの取り組みを通じて、当社は強固なクロスファンクショナル（組織横断的）体制を構築しました。これにより、顧客やサプライヤーを取り巻く環境の変化を迅速に把握し、その洞察を具体的なアクションへと結び付けるとともに、市場環境の変化にも機動的かつ柔軟に対応することが可能となっています。サプライチェーンネットワーク全体における情報連携の高度化を進めることで、当社はあらゆる将来の変化に備える力と機動的な対応力を一段と磨き上げていきます。

こうした取り組みに加え、当社は長年にわたるサプライヤーとの協働を通じ、双方の持続可能な成長を支える長期的な信頼関係を築いてきました。この信頼関係により、今後起こりうる困難な局面も乗り越えていけると考えています。あわせて、サプライチェーンネットワークの拡大と多様化を通じ、サプライチェーンのレジリエンス（強靱性）を一層高めてまいります。

複雑化する事業環境

当社の供給体制が直面する課題は、技術、顧客及び当社のサプライチェーンの3つの側面から捉えることができます。

技術面では、AI産業の急速な進化を背景に、AI関連の半導体において高性能化を追求する動きが加速しています。加えて、3D実装技術など先端パッケージ技術を用い、ロジックやメモリなど異なるチップ同士の高度な集積により、半導体が複雑化しています。こうした半導体の高度化に伴い、半導体の設計や製造上の課題は増大する一方で、顧客はより短期間での製品開発サイクルを求められています。

また顧客の視点では、半導体の高性能化、複雑化に伴い、顧客自身のサプライチェーンの管理は一層難しくなっています。地政学的要因を背景に顧客は地域ごとのサプライチェーンの最適化や分散化を進めており、調達・生産・供給といった、一連の体制の再構築が必要となっています。加えて、半導体の設計・製造難易度の上昇に伴い、顧客自身がテストの必要台数を把握することも一段と難しくなっています。特に、次世代半導体の立ち上げ時には不確実性が高く、歩留まりやテスト時間などの製造条件は大きく変動する可能性があります。

当社もまた、自社のサプライチェーンにおいてさまざまな課題に直面しています。当社のテストは多種多様な部品で構成されており、たった一つの部品が欠けるだけでも製品を完成させることができません。さらに、当社製品の製造に必要な部材について、産業全体で需給が逼迫し、部材の調達競争が生じる場

リヒャルト ユンガー

経営執行役員
Chief Supply Chain Officer (CSCO)



サプライチェーンの拡張性とレジリエンス強化に向けた戦略

面もあり、安定的かつ機動的な調達の難易度は高まっています。そのため、サプライチェーン全体を最適に統括・運営するための新たな手法が求められています。

サプライチェーン高度化戦略

このような変化する事業環境を踏まえ、当社はスケール、レジリエンス、スピードの3つの追求を軸としたサプライチェーン高度化戦略を推進しています。

まずスケールですが、この業界では出荷能力の確保が重要な競争力の源泉となります。そのため当社では、サプライチェーン全体を対象に「Just in Case」のアプローチを採用しています。その中核となるのが「戦略的なシナリオプランニング」です。具体的には、顧客需要、業界動向、ウェハ投入量、技術トレンド、供給能力など幅広い市場指標を取り入れて、需要が大きく伸びるケース、予想どおりのケース、低調なケースといった複数のシナリオを策定し、継続的に見直しています。当社内のクロスファンクショナルチームに加え、サプライヤーとも緊密に連携し、適切なバッファー戦略やサプライチェーンの状況の可視化を通じて、市場変動に迅速かつ効果的に対応できる能力の強化を図っています。

レジリエンスの観点では、当社はサプライヤー基盤及び生産拠点の分散・多

様化を進めており、今後も継続していきます。具体的には、重要部材のマルチソーシング、複数拠点での生産体制、長期供給契約の活用に加え、サプライチェーン各層におけるバッファー在庫戦略を組み合わせることで、安定供給体制の強化を図っています。これらは単なるリスクに備えた対応ではなく、不確実性の高い環境下でも顧客への供給責任を果たすための戦略的な投資です。特に在庫の戦略的な確保は、突発的な需要増加への対応と供給途絶リスクへの備えの両面を担っており重要な施策です。一方、当社製品の世代切り替え時には、在庫の陳腐化リスクにも十分配慮し、事業部門と緊密に連携しながら供給力確保と在庫効率の最適なバランスを図っています。

最後に、顧客の製品開発サイクルが一段と短期化する中で、スピードの重要性は一層増しています。当社は、顧客の技術開発のスピードに的確に対応し、新たな成長機会を確実に捉えるため、製品ごとに設計の初期段階から最適な供給体制を見極め、量産立ち上げ時のスケラビリティも織り込んだ体制を構築しています。また、当社は市場投入までの期間（Time to Market）の短縮と量産体制確立までの期間（Time to Volume）の迅速化を図り、需要拡大局面にも機動的かつ効果的に対応できる供給能力の構築に取り組んでいます。

組織横断連携とパートナー協業による競争力強化

上述したサプライチェーン高度化戦略には、2つの重要な要素が根底にあります。

まず、R&D、事業部門、サプライチェーン、営業チームが一体となって価値創出に取り組むクロスファンクショナルな連携体制を構築しています。各部門が個別最適ではなく、全体最適の視点で意思決定を行うことで、市場環境の変化にもより迅速かつ柔軟に対応することが可能となっています。

こうした連携は、製品ライフサイクルの初期段階から始まります。当社は、製品の設計段階から、生産立ち上げ、顧客対応まで、一貫してQCD*の観点を考慮しています。品質は最終工程で確保するものではなく、製品設計・調達・製造にいたるすべてのプロセスに組み込むことが重要であると考えています。この統合的なアプローチにより、顧客が当社に期待する高い品質を維持しながら、供給能力の拡大を実現しています。

急速な技術革新や需要変動、供給制約など事業環境の不確実性はますます高まっています。こうした環境変化に対応するため、当社は前述の「戦略的シナリオプランニング」のもと、部門横断で情報を共有しながら複数のシナリオを検討・

機動的なサプライチェーンを実現する4つのステップ



サプライチェーンの拡張性とレジリエンス強化に向けた戦略

評価し、事業動向や市場環境の変化に応じてサプライチェーンを機動的に最適化しています。このような連携は単なる部門間協力にとどまらず、全社的な実行力を高めるとともに、当社の競争力の源泉となっています。

*QCD: Quality (品質)、Cost (コスト)、Delivery (納期)

2つ目の要素は、サプライヤーとの協働の深化です。当社の生産は外部委託と自社製造を組み合わせたハイブリッド生産モデルを採用しており、製品ごとに最適なサプライチェーンを構築し、両者のバランスを図っています。例えば、少品種大量生産の製品、もしくは組み込むボードに応じて自在

にカスタマイズできる製品は、EMS (電子機器受託製造サービス) パートナー企業に全面的に生産を委託し、彼らの規模と製造ノウハウを活用しています。一方で、少量生産で高度な複雑性を持つ製品については自社製造で対応しています。いずれの製品も設計・生産の両面で高度な専門性が求められるため、当社の設計、エンジニアリング、サプライチェーンの各チームが緊密に連携し、製品の精度と品質を担保しています。外部委託と自社製造を戦略的に組み合わせることで、需要変動への柔軟な対応を可能にするとともに供給途絶リスクの分散にも寄与しており、当社のスケラビリティとレジリエンス強化の両立を支える強固な基盤となっています。

サプライヤーとのパートナーシップによるハイブリッド生産体制

製品ごとに最適化したサプライチェーン体制

EMS パートナー

大量生産・少品種／
柔軟な仕様構成が
可能な製品

自社生産

少量生産・
高複雑度の製品

部門横断の連携



研究開発



事業部門



サプライチェーン



営業



財務

提供価値(アウトカム)

最後に、当社の提供価値について整理します。当社は、顧客及びサプライヤーを重要なステークホルダーと位置付けており、それぞれに提供すべき価値は以下と分析しています。

顧客

- 顧客課題の解決を通じた顧客の事業成長への貢献
- 顧客の環境課題改善への寄与

サプライヤー

- 事業成長機会の拡大
- 持続可能な社会価値の共創

これらの提供価値を生み出すためには当社自身が、「持続的な成長を実現できる企業」である必要があります。その実現に向け、当社は最先端のテストソリューションを顧客が必要なときに適切に提供し、課題解決に貢献することで、半導体のイノベーションを支えながら、より良い社会の実現に貢献していきます。

サプライヤーとの関係においても、安定した需要創出と中長期の成長機会を共有しながら、持続可能な調達・供給基盤とともに築き、社会価値の共創を実現していきます。当社はこのような価値を提供することで、顧客とサプライヤーからさらなる信頼を勝ち得るよう今後も邁進してまいります。

顧客

顧客課題の解決を
通じた顧客の事業成長
への貢献

顧客の環境課題
改善への寄与

ADVANTEST®

サプライヤー

事業成長機会の
拡大

持続可能な
社会価値の共創

人財戦略の実行を支える仕組みと施策

アドバンテストは、共通の価値観であるINTEGRITYを基盤に、従業員一人ひとりの成長と組織能力の向上を支える人財施策をグローバルに展開しています。

事業部門を支える体制の整備、役割やキャリア段階に応じた能力開発、採用から育成、リテンション、キャリアのトランジションまでを一連のプロセスとして捉えた支援を通じて、多様な人財が継続的に能力を発揮できる環境づくりを進めています。

1. 事業を支えるグローバルHC体制

事業のグローバルな拡大や急激な変化、組織の多様化に伴い、人財部門に求められる役割も変化しています。各地域の法制度や労働市場に対応することに加え、事業部門が必要とする人財や能力を把握し、グローバルに蓄積された専門性や人財施策を効果的に活用することが求められています。

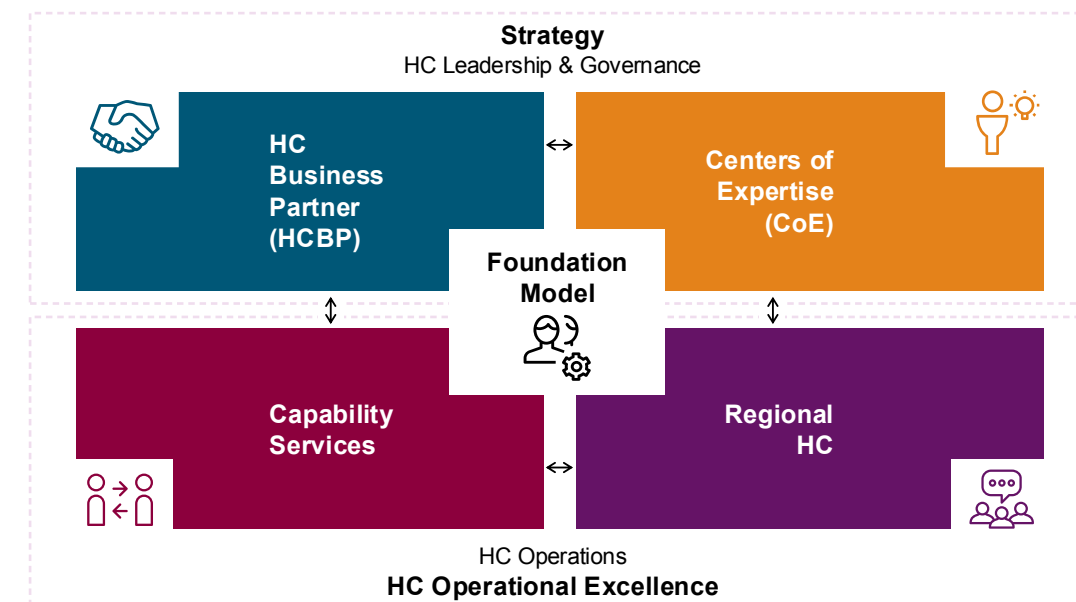
従来、人財部門による事業支援は地域単位を主軸に行われる傾向がありました。今後は、地域ごとの事情に対応しながら、各地域が持つ人財や専門性を必要に応じて組織全体で活用できる、よりグローバルな支援体制への移行を進めています。

当社では、事業部門と人財部門の連携を強化するため、Global Human Capital Transformation (GHCX) という考え方に基づき、2026年9月よりHuman Capital Business Partner (HCBP) を新たに設けています。HCBPは、担当するBU・FUの戦略を理解し、事業側のニーズを各地域の人財部門につなぎます。また、BU・FUにおける会議や戦略に関する議論に参加することで、事業の方向性や、将来必要となる人財・能力を明確化し、準備を進めます。

グローバルなHC体制では、「HCBP」に加え、各人財領域の専門分野を担う「Center of Expertise」と、グローバルオペレーションを担う「Capability Service」、各地域でのオペレーションを担う「Regional HC」が連携します。

Center of Expertiseは、人財に関する専門的な知見やグローバル共通のポリシーを提供します。Capability Serviceはグローバルで標準化されたオペレーションを担いつつさらなる効率化と付加価値創出を進めます。Regional HCは、それぞれの地域における制度や文化、事業環境や労働市場を踏まえ、現地の従業員や組織を支援します。HCBPが把握した事業側のニーズをこれらの機能につなぐことで、事業に必要な人財施策の検討と実行を支えます。

Global Human Capital Transformation (GHCX) のフレームワーク



人財戦略の実行を支える仕組みと施策

2. 体系的な人財育成と専門性の向上

当社では、従業員一人ひとりの能力を高める「個の力」と、人財の知識や経験を組織全体の成果につなげる「組織の力」の両輪を強化することを、人財育成の基本的な考え方としています。この二つを継続的に高めることで、人的資本の蓄積を進め、従業員エンゲージメントの向上と中長期的な価値創造につなげています。

従業員がそれぞれの役割やキャリア段階に応じて必要な能力を身につけられるよう、Advantest Development Frameworkに基づく人財育成を進めています。同フレームワークでは、すべての従業員に共通して求められる基礎スキルから、上級スキル、リーダースキル、シニアリーダー及び経営層に求められるスキルまでを体系的に整理しています。技術系・非技術系を問わず、従業員に明確なキャリアパスを示すとともに、それぞれの目的や成長段階に応じた学習機会を提供しています。

能力開発においては、研修などの体系的な学習機会と、実務を通じた育成を組み合わせています。特に技術分野では、経験豊富な従業員とともに実際の顧客課題に取り組むOJTを通じて、業務に必要な知識や専門性を高めています。

また、個人が業務を通じて得た知識や経験を、チームや部門、地域を越えて共有することも重視しています。一人ひとりの専門性を高めるだけでなく、その知見を組織の中に蓄積し、他の従業員の学習や業務改善に生かすことで、「個の力」を「組織の力」へとつなげています。

こうした取り組みを通じて、従業員の継続的な成長を支援するとともに、将来の事業成長を担う人財と組織能力の強化を進めています。

Advantest Development Framework

3. Employee Lifecycleを通じた成長とエンゲージメントの支援

当社は、従業員との関係を、採用前の接点から入社、能力開発、リテンション、キャリアの移行までを含む一連のライフサイクルとして捉えています。Advantest Employee Lifecycleに基づき、各段階に応じた施策を切れ目なく展開することで、従業員一人ひとりの成長を支え、個人の成長と会社の事業目標が連動する環境づくりを進めています。

Attraction（引きつけ）では、当社の事業、職務内容、企業文化、働く環境について情報を発信し、将来の人財との接点を形成します。続くRecruiting（採用）では、事業や組織が必要とする能力や専門性を踏まえ、適切な人財の獲得に取り組んでいます。

入社後のOnboarding（受け入れプロセス）では、当社の企業文化や事業、組織の仕組み、仕事の進め方、社内制度

などへの理解を促進します。The Advantest WayやINTEGRITYについて学ぶ機会も設け、従業員が組織の一員として円滑に力を発揮できるよう支援しています。

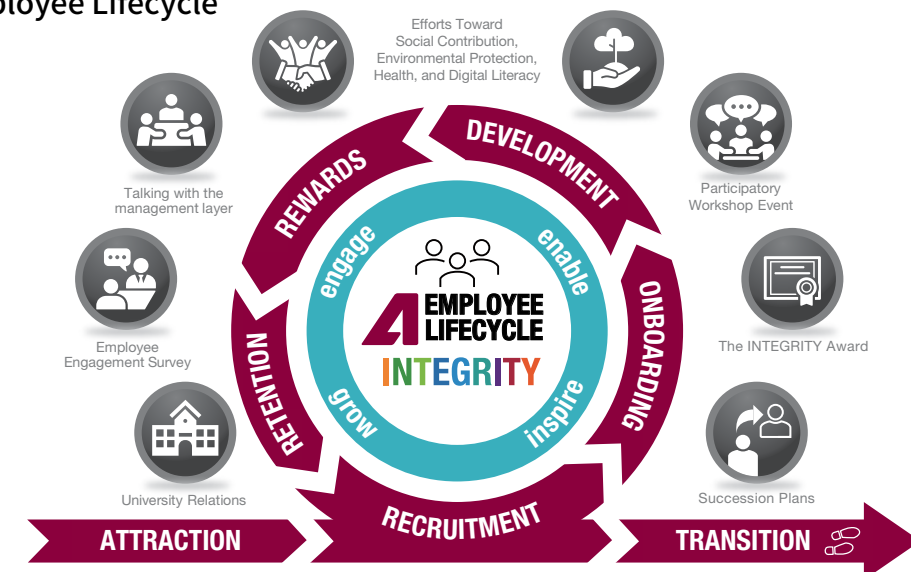
その後のDevelopment（育成）では、Advantest Development Frameworkに基づく学習プログラムやOJTを通じて、役割やキャリア段階に応じた能力開発を行います。また、マネージャーとの継続的な対話やフィードバックを通じて、業務上の目標、能力開発、今後のキャリアについて確認する機会を設けています。

Rewards（報酬）及びRetention（定着）の段階では、従業員の貢献を適切に評価するとともに、エンゲージメントを高め、継続的に能力を発揮できる職場環境の整備に取り組んでいます。従業員エンゲージメントサーベイを継続的に実施し、その結果をグローバル、地域、組織などの単位で分析することで、それぞれの課題に応じた改善活動につなげています。

さらに、従業員が次の役割やキャリアへ円滑に移行できるよう、オフボーディングを含むTransition（移行）もEmployee Lifecycleの重要な段階として位置付けています。キャリアの各段階を通じて継続的に支援することで、従業員一人ひとりの成長と、組織の持続的な発展の両立を目指しています。

INTEGRITYの浸透についても、採用、オンボーディング、能力開発、評価、日々のマネジメントなど、Employee Lifecycleの各段階を通じて取り組んでいます。従業員向けのワークショップや管理職向け研修などを通じて、INTEGRITYを日々の判断や行動、リーダーシップ、チームでの協働につなげています。

Advantest Employee Lifecycle



リスクマネジメント

基本的な考え方

当社グループでは、コーポレート・ビジョンである「半導体バリューチェーンで最も信頼でき、最も価値あるテストソリューション・カンパニーへ (Be the most trusted and valued test solution company in the semiconductor value chain)」の体現を阻害する要因をリスクファクターと定義し、その低減を図ることにより中長期的な企業価値向上を目指しています。

その中でも、各国法令及び「The Advantest Way」に反する行為については、当社グループの価値基盤を毀損するものとして許容しない(ゼロトレランス)方針を採っています。他方で、戦略目標の達成及び価値創造に資するリスクについては、許容可能な範囲を踏まえつつ、各ステークホルダーからの期待を経営会議における検討を通じて成長施策に落とし込み、当社として中長期的にありたい姿を実現することを重視しています。

リスクユニバース

当社グループでは、コーポレート・ビジョンの体現を阻害するリスクファクターを一元的に整理した「リスクユニバース」を策定しています。リスクユニバースは、マクロ経済、業界動向、法規制、ステークホルダーの期待等の情報を踏まえて構成しており、内部要因・外部要因を問わず、当社が認識するリスクを体系的に整理したものです。戦略的リスク、オペレーショナルリスク、財務リスク、法務・コンプライアンス・グループガバナンス・知的財産権リスクの4つのリスクカテゴリーから構成されます。戦略的リスクは「外部環境変化や事業上の重要な判断等、企業価値創造および成長戦略の達成に影響を及ぼすリスク」を指し、その他は「経営基盤の維持および経営方針・戦略の円滑な遂行に影響を及ぼすリスク」を指します。また、変化の激しい事業環境を踏まえ、当面は発生確率が低いと見なされるものの大きな影響を及ぼし得る極端リスク(エクストリームリスク)についても、リスクユニバースに包含し、有事への備えの強化に努めています。

リスクユニバースに包含される各リスクの詳細については、2026年3月期有価証券報告書兼事業報告書「第2 事業の状況 3. 事業等のリスク」をご参照ください。

リスクユニバース

1.戦略的リスク				
a.市場変動	b.顧客からの信頼	c.政治・地政学	d.成長投資	e.顧客ポートフォリオ
2.オペレーショナルリスク	3.財務リスク	4.法務・コンプライアンス・グループガバナンス・知的財産権リスク		
a.情報セキュリティ及び業務効率	a.為替変動	a.人権・ハラスメント・DEI※		
b.サプライチェーン	b.信用格付	b.倫理及びコンプライアンス		
c.製品ライフサイクル	c.税務	c.責任ある事業運営		
d.自社の事業継続		d.貿易管理		
e.人財		e.グループガバナンス及び内部統制		
		f.知的財産権		
		g.訴訟		

※DEI: Diversity, Equity and Inclusion (多様性、公平性及び包摂性)



リスクマネジメント

戦略的リスクに対して、当社では下記のような取り組みを行い、リスクの低減を図っております。

リスクの概要	リスク低減策
a. 市場変動 半導体設備投資水準の変動により、当社グループの業績及び将来業績に大きな影響が生じる可能性	• 当社グループは、開発フェーズから量産フェーズまで、半導体のテスト需要を網羅する製品ポートフォリオの構築や、リカーリング商材を含むサービス事業の強化を通じて、半導体及びその関連装置市場の変動影響の緩和を図っています。 • あわせて、半導体市場の動向や技術トレンド、試験装置需要見通しの継続的な把握を通じて、市場変動への対応力向上に努めています。これらを踏まえ、サービスエンジニアや開発エンジニアの人員配置についても、機動的な最適化を図っています。販売プロセス、サプライチェーン管理及び製販間の連携については、デジタルツールの活用等を通じて改善を進めているほか、与信管理及び売上債権回収リスクについても適切な管理に努めています。 • さらに、当社製品の需要が急峻に増加した場合の供給対応力を高めるため、また中長期的な需要増加見通しを踏まえ、戦略的な在庫バッファの保有及び計画的な生産キャパシティの増強に取り組んでいます。 • 財務面においては、半導体及びその関連装置市場の変動が短期間で複合的に顕在化する可能性がある事業環境を前提として、コスト構造の変動費化、資金調達枠の確保に係る契約の締結、キャッシュ・コンバージョン・サイクルの改善等を通じ、半導体市場の減速局面における業績の下方耐性強化及び財政健全性の確保に平時より取り組んでいます。
b. 顧客からの信頼 顧客対応が顧客の期待水準に達しない場合、当社グループに対する信頼が低下し、取引の継続や成長機会獲得が制約される可能性	• 顧客からの信頼を維持・向上させる基盤として、当社グループは、技術理解力及び顧客対応力の強化に取り組んでいます。具体的には、主要顧客と将来のテストソリューションに関する技術情報交換の機会を設けることで、次世代半導体の技術、製品仕様、将来の顧客課題、及び顧客課題を解決するテストソリューションの洞察に努めています。さらに、長期を見据えた要素技術の基礎研究や次期自社製品の量産技術の開発を並行して進めることで、顧客の期待に応える製品・ソリューションをタイムリーに提供する体制を構築しています。 • また、顧客対応力を高めるためには、顧客のニーズをよりの確に捕捉する能力の涵養と、汲み取ったニーズをソリューション提案として具現化する能力の実装が、ともに不可欠です。当社グループにおいて顧客に対し最も密な対応が求められるシステムエンジニア (SAE) に対しファシリテーション能力強化研修を実施しているほか、AIを活用した顧客対応能力や製品開発能力の拡充も推進しています。 • これらの取り組みを通じ、当社グループは、半導体テストを核とした当社のテストソリューションの価値を、これまでより広い範囲の半導体バリューチェーンですでに訴求し始めています。直近事例としては、シリコン検証を自動化する画期的なソリューション「SiConic®」の提供を開始しています。またプローブカード・メーカーやプローバ・メーカーなどの外部パートナーとの協業や技術提携を通じて、顧客課題を解決する新たな製品・ソリューションの開発に取り組んでいるほか、サービスの充実にも取り組んでいます。 • これら製品・ソリューション群を拡充する取り組みを通じ、顧客製品の品質・信頼性向上や顧客の設計・製造オペレーションにおける生産性向上により多くの貢献を果たすことで、今後も業界で顧客から最も厚い信頼を寄せられる企業となることを目指しています。



リスクマネジメント

リスクの概要

c. 政治・地政学

地政学的緊張や経済安全保障を背景とした各国の規制環境の変化により、当社グループの調達・製造・販売等の事業活動が制約を受ける可能性

リスク低減策

- 地政学的リスクの高まりに伴い、各国における貿易・投資・技術管理に関する規制環境が変化する可能性に備え、当社グループは、事業活動への影響を適切に把握し、必要な対応を講じています。
- 具体的には、関税、輸出管理規制、経済制裁等に関する動向について、信頼性の高い情報源を活用し、地政学動向を継続的にモニタリングしています。また、地政学的リスクが事業に与える影響を多面的に把握するため、地域別のリスクを踏まえたシナリオ分析を行い、事業への影響を評価しています。
- さらに、業界団体や専門委員会等への参画を通じて、半導体産業を取り巻く政策動向や規制議論に関する情報収集及び意見交換を行うとともに、半導体産業に対する過度な規制の回避や影響の低減に向けた取り組みを行っています。

d. 成長投資

成長投資において想定した成果が十分に実現せず、中長期的な企業価値の向上が制約される可能性

- 当社グループは、今後当社が有すべき技術若しくは事業ポートフォリオ、ビジネスモデル、オペレーティングモデルの方向性を、業界におけるテクノロジー・リーダー企業や有識者とのコミュニケーションを通じて把握することに努めています。また得られた知見をもとに、"Automation of Test" をキーワードとした提供ソリューション群の革新、近縁市場における成長機会の具体化、新たな半導体関連の事業領域の探索等、事業と収益源の拡充につながる取り組みを行うことで、当社グループの中長期的かつ持続的な発展に努めています。
- さらに、投資判断プロセスにおける規律を整備することでも、投資計画の精度向上及び投資リスクの低減を図っています。特に研究開発投資は、将来の事業成長性と事業収益性を左右する重要な投資であり、顧客ニーズを満たす製品ロードマップの策定とそれに基づく人員計画の策定、製品のプラットフォーム化等による開発効率向上、ROICベースの投資効果予測と判断等により、投資回収率の向上と投資リスクの軽減を図っています。企業買収や資本業務提携についても、投資効果予測の他、対象企業の技術優位性、当社グループのコアコンピタンスとの整合性、企業カルチャーの親和性等を総合的に検討した後に投資判断を行っています。

e. 顧客ポートフォリオ

売上高において上位顧客の数社が大きな割合を占めるため、大口顧客の投資判断や取引関係の変化が当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性

- 当社グループは、顧客ポートフォリオに起因する業績変動リスクを低減するため、既存顧客とのさらなる関係強化と将来の成長機会へのアクセスの両面から、収益機会の多様化と収益の安定拡大に努めています。
- 具体的には、既存顧客の満足度をさらに引き上げるべく、顧客ごとの中長期的な技術動向や事業戦略、設備投資計画に対する理解を継続的な対話を通じて深め、さらにそれらに対する適切な対応を行っています。あわせて、規模の大小を問わず多様な顧客の成長を支援する観点から、既存顧客に加えて将来の重要顧客に対しても専任体制の構築を含むサービス体制を整備し、顧客ごとの課題やニーズに応じたきめ細かなサービスの提供を通じて当社グループへの信認拡大に取り組んでいます。さらに顧客基盤の拡大に向け、成長が期待されるインド等の市場において現地法人のオペレーション体制を強化したほか、一部地域で外部パートナーとの戦略的な提携を通じ、有望顧客や新たな成長機会へのアクセス強化に取り組んでいます。